

关于深圳市科通技术股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的 审核中心意见落实函的回复

保荐机构(主承销商)



(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401)

二〇二四年一月

深圳证券交易所:

贵所于 2023 年 9 月 21 日出具的《关于深圳市科通技术股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》(审核函〔2023〕010346号)(以下简称"审核落实函"或"落实函")已收悉,深圳市科通技术股份有限公司(以下简称"科通技术"、"公司"、"发行人")与保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"、"保荐机构")、发行人律师广东信达律师事务所(以下简称"发行人律师")和申报会计师大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"申报会计师"、"会计师")等相关各方对落实函所列问题进行了逐项落实、核查,现回复如下(以下简称"本回复"),请予审核。

除另有说明外,本回复中的简称或名词的释义与《深圳市科通技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(上会稿)》(以下简称"招股说明书")中的含义相同。

落实函所列问题	黑体(不加粗)
对落实函所列问题的回复	宋体 (不加粗)

目 录

问题 1.关于供应商返利及合作稳定性	3
问题 2.关于期后业绩与存货	30
问题 3.关于历史股东优车易购(香港)与对赌协议	76
问题 4.关于信息披露	96

问题 1. 关于供应商返利及合作稳定性

申报材料及审核问询回复显示:

- (1)报告期内,上游原厂供应商对发行人存在返利;其中,供应商赛灵思产线的各期返利金额占发行人对其采购金额的比例分别为 91.36%、86.30%、86.77%,高于其他供应商的返利比例。
- (2) 赛灵思等供应商对发行人存在合规性要求,其中包括每2至3年对发行人开展一次分销商现场审计。

请发行人:

- (1) 说明报告期内 FPGA、ASIC、处理器芯片、模拟芯片、存储芯片等主要产品中存在返利产品的采购金额及占比情况、扣除返利后采购金额及占比情况、相关供应商情况;报告期内存在返利的同类产品在不同供应商的返利比例差异,扣除产品返利后的实际采购单价与向其他供应商采购价格的对比情况,实际采购价格的公允性。
- (2) 结合各类产品供应商采购返利比例情况、存在差异的原因及合理性分析等,进一步说明赛灵思等供应商返利比例较高的原因及合理性,相关返利的真实性。
- (3) 结合与赛灵思等主要供应商的合作协议以及续约条件、历史上更换供应商的频率、相关国际贸易政策变化以及对发行人审计情况、审计结论等进一步论证双方合作的可持续性,返利政策的稳定性;发行人针对供应商的合规性政策、国际贸易政策的内控措施及有效性,是否存在影响持续经营能力的相关风险;就上述事项在招股说明书"重大事项提示"部分补充提示相关风险。

请保荐人、申报会计师发表明确意见,并进一步说明针对供应商返利真实性核查的充分性、核查结论。

回复:

发行人代理的大部分为欧美知名芯片原厂的芯片,欧美芯片原厂基于其芯片的全球定位和价格管理需求,对授权分销商采取 POS 模式进行销售,即授权分销商按照芯片原厂全球统一目录价格(Book Price)采购芯片,向下游实现销售

后,授权分销商再向原厂申请返利,原厂按照返利后的实际结算价向授权分销商 开具采购价款抵扣凭证(Credit Note)。报告期内,发行人主要以 POS 模式进行 采购销售,该模式下的采购金额分别为 1,197,771.04 万元、2,689,162.22 万元、 2,912,076.15 万元和1,274,285.95 万元,占当期总采购金额的比例分别为 90.99%、 94.05%、95.01%和 92.71%。

各家芯片原厂的返利比例不尽相同,其中赛灵思的返利比例较高。各原厂供应商根据自身的销售策略、每笔销售订单的产品型号、终端客户应用领域、产品销售数量等多重因素审批决定产品的实际结算价,进而确定返利金额,各原厂之间的返利比例通常不具有可比性,同一供应商的返利比例也可能存在一定波动。其中,Xilinx 的返利比例在报告期各期均超过 90%,高于其他各家原厂的返利比例,赛灵思原厂已通过访谈和书面确认等方式对该情形进行确认。

因此,发行人各类产品的返利比例普遍较高是由商业模式决定的,其中赛灵思高于其他原厂的返利比例,发行人返利比例较高具有合理性。

- 一、说明报告期内 FPGA、ASIC、处理器芯片、模拟芯片、存储芯片等主要产品中存在返利产品的采购金额及占比情况、扣除返利后采购金额及占比情况、相关供应商情况;报告期内存在返利的同类产品在不同供应商的返利比例差异,扣除产品返利后的实际采购单价与向其他供应商采购价格的对比情况,实际采购价格的公允性
- (一)说明报告期内 FPGA、ASIC、处理器芯片、模拟芯片、存储芯片等主要产品中存在返利产品的采购金额及占比情况、扣除返利后采购金额及占比情况、相关供应商情况

题干信息所述"供应商赛灵思产线的各期返利金额占发行人对其采购金额的比例分别为 91.36%、86.30%、86.77%",该数据来源于原第二轮问询意见回复之第 7 题,该返利金额口径为发行人该产品线各期实现收入计提的返利金额。为了准确反应本题所述采购金额中包含的返利,下述回复的返利金额口径为采购金额中包含的返利。

1、存在返利产品的采购金额及占比情况、扣除返利后采购金额及占比情况 报告期内,FPGA及组件、ASIC、处理器芯片、模拟芯片、存储芯片等主要 产品中存在返利产品的采购金额及占比情况、扣除返利后采购金额及占比情况如下表所示:

单位:万元

产品类别	存在返和 的采购		2023 年 1-6 月	2022年	2021年	2020年
	名义口径	金额	1,040,276.26	2,255,908.86	2,119,962.36	942,000.97
FPGA	石 人口任	占比1	99.92%	100.00%	99.28%	99.81%
及组件	实际口径	金额	54,590.76	182,299.76	154,287.58	72,763.72
	关 附口任	占比1	98.52%	99.95%	90.98%	97.59%
	タリロタ	金额	50,442.98	178,466.25	102,784.80	51,829.74
ASIC	名义口径	占比	89.12%	95.96%	90.65%	83.75%
ASIC	实际口径	金额	36,657.96	126,226.37	86,408.67	48,774.44
	- 	占比	85.61%	94.39%	89.07%	82.90%
	カツロ気	金额	107,551.39	222,873.10	151,169.01	45,644.05
处理器	理 器 名义口径	占比	84.64%	87.99%	77.47%	54.02%
芯片	实际口径	金额	69,016.22	159,467.05	110,368.07	21,023.97
	关 阶口征	占比	77.96%	83.98%	71.51%	35.11%
	名义口径	金额	12,038.81	80,360.81	106,080.79	54,828.84
存储	石 人口任	占比	30.89%	83.55%	90.21%	86.87%
芯片	实际口径	金额	4,302.87	36,643.62	53,838.29	35,149.28
	- 	占比	13.77%	69.84%	82.38%	80.92%
	名义口径	金额	55,824.62	134,853.52	149,473.95	107,638.32
模拟	1 4 人口任	占比	76.53%	75.43%	68.60%	77.46%
芯片	☆ 陸ロタ	金额	47,959.06	117,050.63	134,996.67	100,477.76
	实际口径	占比	73.69%	72.71%	66.37%	76.24%

注 1: 名义口径占比=存在返利产品的名义采购金额/总名义采购金额;实际口径占比=存在返利产品的实际采购金额/总实际采购金额。

从实际采购金额来看,报告期内 FPGA 及组件中含返利的采购金额占比分别为 97.59%、90.98%、99.95%、98.52%,采购的绝大部分产品均含有返利。报告期内 ASIC 中含返利的采购金额占比分别为 82.90%、89.07%、94.39%、85.61%,采购的大部分产品均含有返利。报告期内处理器芯片中含返利的采购金额占比分别为 35.11%、71.51%、83.98%、77.96%,采购的大部分产品均含有返利。报告期内存储芯片中含返利的采购金额占比分别为 80.92%、82.38%、69.84%、13.77%,除 2023 年 1-6 月外,报告期其他期采购的大部分产品均含有返利; 2023 年 1-6

月存储芯片中存在返利产品的采购额占比下降比例较大,主要系当期发行人增加对国内长江存储等供应商存储产品的采购,该等供应商不存在返利条款。报告期内模拟芯片中含返利的采购金额占比分别为76.24%、66.37%、72.71%、73.69%,采购的大部分产品均含有返利。

由此可见,报告期各期,除 2023 年 1-6 月存储芯片采购金额中返利比例较低外,发行人各类产品的采购金额中均包含较高比例的返利。

2、各类产品主要供应商情况

报告期内,FPGA 及组件中涉及返利的主要供应商为 Xilinx、Intel; ASIC 中涉及返利的主要供应商为 Realtek、Nvidia (含 Mellanox)、Skyworks、Microchip、Intel; 处理器芯片中涉及返利的主要供应商为 Intel、Microchip、ST、Maxlinear、AMD;存储芯片中涉及返利的主要供应商为 Micron、Microchip、ST、SanDisk、Xilinx;模拟芯片中涉及返利的主要供应商为 Osram、Skyworks、SGMC、Ampak、Maxlinear。前述供应商的基本情况、发行人从前述主要相关供应商采购产品的情况、返利比例情况如下表所示:

供应商	供应商介绍	主要产品类别	2023年 1-6月	2022 年	2021年	2020年
Xilinx	Xilinx 为前纳斯达克上市公司 (XLNX.O),是全球 FPGA 解决方 案的领导厂商,2022 年被纳斯达克 上市公司 AMD(AMD.O)收购	FPGA 及组件、处理器芯片、存储芯片		91.70%	92.94%	92.07%
Intel	纳斯达克上市公司(INTC.O),是 全球最大的个人计算机零件和半导 体芯片制造商	FPGA 及组件、 ASIC、处理器芯片	36.81%	30.21%	21.55%	无采购2
Realtek	台交所上市公司(2379.TW),是全球顶尖的 IC 供应商之一	ASIC、模拟芯片	5.26%	7.16%	4.95%	3.96%
Nvidia /Mellanox 3		ASIC、存储芯片、 模拟芯片	37.89%	44.94%	41.60%	44.14%
	纳斯达克上市公司(SWKS.O),是 全球知名的无线网络领域的高性能 模拟半导体公司	ASIC、模拟芯片	19.02%	9.42%	3.10%	1.76%
		ASIC、处理器芯片、存储芯片、模 拟芯片		49.95%	54.62%	59.63%
	纳斯达克上市公司(MXL.O),是 一家全球知名的射频模拟、数字与混 合信号集成电路供应商	ASIC、处理器芯片、模拟芯片	28.05%	37.25%	7.36%	无采购

供应商	供应商介绍	主要产品类别	2023年 1-6月	2022 年	2021年	2020年
SGMC	深交所创业板上市公司 (300661.SZ),是国内知名的芯片 设计公司	ASIC、模拟芯片	32.08%	21.11%	23.81%	29.31%
ST	纽交所上市公司(STM.N),是世界 最大的半导体公司之一	处理器芯片、存储 芯片、模拟芯片	45.08%	39.37%	40.17%	50.59%
Micron	纳斯达克上市公司(MU.O),是全球领先的存储芯片的设计公司之一	存储芯片	59.17%	32.57%	41.04%	43.70%
Sandisk	前纳斯达克上市公司(SNDK.O), 是全球最大的闪速数据存储卡产品 供应商之一,2015 年被西部数据 (Western Digital)收购	存储芯片	50.01%	57.38%	46.51%	25.95%
Osram	法兰克福和慕尼黑证交所上市公司 (OSR.DF),是全球领先的单片机、 模拟半导体、照明产品与光电半导体 供应商		0.61%	2.17%	1.54%	0.38%
Ampak	台交所上市公司(6546.TW),是知 名无线物联通信模块品牌商	模拟芯片	0.50%	0.01%	0.01%	0.02%

- 注 1: Xilinx 在 2022 年被 AMD 收购, 故此处列示为同一供应商合并主体;
- 注 2: 2020 年,发行人主要通过曼诚技术购买 Intel 产品;
- 注 3: Mellanox 在 2020 年被 Nvidia 收购, 故此处列示为同一供应商合并主体;
- (二)报告期内存在返利的同类产品在不同供应商的返利比例差异,扣除 产品返利后的实际采购单价与向其他供应商采购价格的对比情况,实际采购价 格的公允性
- 1、"同类产品"并非"相同产品",同类产品中的绝大部分产品不具有替代性,实际采购价格之间通常不具有可比性
- (1) 招股说明书中披露的"产品类别"系发行人结合自身业务特点及芯片 类型的分类结果,同类产品中的绝大部分产品不具有替代性

发行人拥有 80 余条芯片产品的代理权,为了便于投资者理解,发行人结合自身业务的特点以及芯片的类型将产品分类为"FPGA 及组件"、"ASIC"、"处理器芯片"、"存储芯片"、"模拟芯片",各类产品具体如下:

A. FPGA 与传统的固定功能芯片相比,其具有高度灵活性和可重构性。FPGA 允许设计人员在硬件级别上重新定义电路功能,通过将逻辑门和存储单元按照自定义的方式组合来实现各种不同的功能。这种可编程性使得 FPGA 在快速原型研发、系统调试、加速计算、信号处理和数字逻辑应用等领域广泛应用。组件,主要系指专业用于 FPGA 的软硬件开发工具、FPGA 评估板卡及 FPGA 成品板卡。

- B. ASIC 是专为特定应用或特定功能而设计和定制的芯片,具有高度优化的电路结构和性能。与 FPGA 不同,ASIC 芯片在制造过程中是固化的,其电路结构和功能无法修改或重新编程,适用于大规模生产和对性能、功耗和尺寸具有特定要求的应用领域。
- C. 处理器芯片是各类计算机系统中的关键组件,用于执行指令和进行数据处理,负责解码、执行和管理计算机指令,控制和协调计算机硬件的工作。
- D. 存储芯片用于存储和读取数据。根据技术和结构的不同,存储芯片主要包括 SRAM、DRAM、闪存、ROM 等不同类型,在计算机系统和其他电子设备中发挥着重要的数据存储和访问功能。
- E. 模拟芯片用于处理和传输模拟信号,与前述数字芯片不同,模拟芯片主要处理连续变化的信号而非离散的二进制数据,其可以执行各种模拟信号处理任务,包括放大、滤波、混频、模数转换、数模转换等,广泛应用于音频、视频、通信、控制等领域。

但是,归类为前述同一类别的芯片产品("同类产品")通常来自不同供应商,涵盖各种芯片型号,互相之间通常具有不完全相同的功能/性能或特征。以ASIC 芯片中存在返利的主要产品为例进行说明: Realtek 产品线主要为声卡、音频芯片,主要功能为物联网控制、语音、影像等; Nvidia/Mellanox 产品线主要为智能网卡,主要功能为以太网适配器; Skyworks 产品线主要为无线通信芯片,主要功能为无线音频传输; Microchip 产品线主要以太网芯片,主要功能为以太网信号收发等; Maxlinear 产品线主要为射频接收器芯片,主要功能为数据转换,实现信号的转接; Intel 产品线主要为物联网处理器芯片,主要功能为处理来自传感器的原始数据,形成视觉信号; Amazing 产品线主要为电路保护芯片,主要功能包括静电防护、电路保护、高低速转换接口等; SGMC 产品线主要为电源管理芯片,主要功能为充放电管理、电源控制、连接器等。ASIC 芯片中不同供应商的芯片功能不同,相互之间的采购价格不具有可比性。

(2)返利模式是海外原厂主要采用的销售模式,返利比例主要取决于各家 芯片原厂的销售策略

返利模式是海外核心芯片原厂主要采用的销售模式,各家芯片原厂的销售策

略各不相同,原厂供应商根据每笔销售订单的产品型号、终端客户应用领域、产品销售数量等多重因素审批决定产品的实际结算价,进而确定返利金额,同类产品的返利比例可能存在差异,同一供应商的返利比例也可能存在一定波动,因此芯片原厂之间的返利比例通常不具有可比性。

综上,发行人分类的"同类产品"并非"相同产品",同类产品之间的返利 比例和实际采购价格通常不具有可比性。

2、同类产品在不同供应商的返利比例、实际采购单价对比情况

(1) FPGA 及组件

报告期内, FPGA 及组件中存在返利供应商的实际采购金额占当期 FPGA 及组件总实际采购金额的比例分别为 97.59%、90.96%、99.02%、96.71%, 其中主要供应商(如下表所示)的实际采购金额占当期 FPGA 及组件总实际采购金额的比例分别为 97.59%、90.79%、99.02%、96.67%, 该等主要供应商的返利比例、扣除产品返利后的实际采购单价的对比情况如下表所示:

单位:元/颗

序号	供应商	返利比例	实际平均采购单价			
	2023 年 1-6 月					
1	供应商 1-1	95.23%	117.86			
2	供应商 1-2	40.79%	500.48			
		2022 年度				
1	供应商 1-1	92.44%	106.32			
2	供应商 1-2	35.83%	822.82			
		2021 年度				
1	供应商 1-1	93.14%	127.19			
2	供应商 1-2	22.24%	959.86			
	2020 年度					
1	供应商 1-1	92.28%	114.99			
2	供应商 1-2	_2	4,634.36			

注 1: 供应商按照同一控制下合并口径进行统计,下同。

关于返利比例,供应商 1-1 产品线的返利比例各期均高于供应商 1-2 产品线,主要原因如下:供应商 1-1 的 FPGA 芯片在全球市场均具备较强的产品竞争力,

注 2: 2020年,产品线 1-2 采购金额中不存在包含返利的情况,当期列示的平均采购价格为产品线 1-2 产品线平均采购价格。

可广泛应用在 5G 通信、数据中心、尖端工业、高端医疗设备、精密测量仪器、汽车电子等科技前沿领域,供应商 1-1 为了保持灵活的竞争优势,其在全球市场制定了较高的、统一的目录采购价,并根据不同的应用领域给予差异化返利,有利于其在面对全球市场诸多行业的不同客户时保持安全的市场定位。相对而言,发行人代理的供应商 1-2 FPGA 产品主要聚焦于配套图形处理器芯片而使用,应用领域相对集中,返利比例相对较低。供应商 1-1、供应商 1-2 结合自身产品的实际情况,制定了不同的销售策略,使得供应商 1-1 产品线的返利比例与供应商 1-2 产品线的返利比例存在差异。

关于实际采购价,发行人分类为 FPGA 的"同类产品"并非"相同产品",供应商 1-1 及供应商 1-2 的 FPGA 产品之间的实际采购价格通常不具有可比性:

A. 发行人采购产品 1-1 及产品 1-2 的 FPGA 产品在设计功能上不具有可替 代性,产品不具有可比性

1-1 和 1-2 两家公司在 FPGA 产品领域有各自的产品线,在功能上具有差异。 发行人采购 1-1 的 FPGA 产品被广泛应用于各种应用领域,其产品具有高度灵活性和可编程性,能够满足不同复杂度的设计需求,在硬件加速、高带宽处理、数字信号处理、通信等不用技术领域均有广泛的应用;而发行人采购 1-2 的 FPGA 芯片主要来自其旗下子公司 B 公司,B 公司是一家专注于数据中心网络交换芯片的公司。与 1-1 的 FPGA 不同,发行人代理的 B 可编程芯片是专用于交换机领域的可编程交换机芯片,采用了 P4 编程语言来实现灵活的数据包处理和网络功能,其芯片主要用于数据中心网络交换设备,提供高性能和高度定制化的网络转发和处理功能,主要功能为通过网路数据加速来进行数据和图形处理。

因此,1-1和1-2的FPGA产品在应用场景和设计功能上存在显著差异,1-1的FPGA适用于广泛的应用领域,而发行人代理1-2旗下B公司的FPGA芯片是专用于交换机领域的可编程交换机芯片,两条产品线的价格区间通常不具有可比性。

B. 发行人采购 1-1 产品的型号多、价格跨度大,低单价产品的采购数量较多,拉低了平均采购单价,而采购 1-2 产品的型号少,采购的产品主要为单价相对较高的产品

报告期内,发行人采购 1-1 产品的 FPGA 芯片型号较为综合,各期采购的型号数量分别为 637、638、553、464,不同型号产品的价格跨度较大;发行人采购 1-2 产品的型号较少,各期采购的型号数量分别为 9、20、14、28,主要集中于配套图形处理器芯片使用的 FPGA 芯片,价格区间较高且相对集中。具体对比情况如下表所示:

实际采购 价格区间	项目		2023年 1-6月	2022年	2021年	2020年
		产品	线 1-1			
0 元~1,000	型号数(个)		327	354	426	418
元	实际采购金额占比	(%)	62.30%	69.83%	62.31%	60.10%
1,000 元~1	型号数(个)		79	120	136	160
万元	实际采购金额占比	(%)	26.44%	14.23%	24.03%	31.32%
1万元~10万	型号数(个)		53	63	72	52
元	实际采购金额占比	(%)	9.20%	15.68%	12.84%	8.34%
10 万元以上	型号数(个)		5	16	4	7
10 万九以上	实际采购金额占比	(%)	2.06%	0.25%	0.82%	0.24%
		产品	线 1-2			
0 元~1,000	型号数(个)		19	9	14	3
元	实际采购金额占比	(%)	10.17%	19.51%	18.15%	2.41%
1,000 元~1	型号数(个)		7	4	3	5
万元	实际采购金额占比	(%)	66.96%	66.88%	77.70%	88.74%
1万元~10万 元	型号数(个)		2	1	3	1
	实际采购金额占比	(%)	22.87%	13.61%	4.15%	8.85%
10 포르이 노	型号数(个)		-	-	-	-
10 万元以上	实际采购金额占比	(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

如上表所示,发行人采购 1-1 和 1-2 产品的价格分布差异较大,且发行人采购 1-1 产品型号、数量较多、价格区间跨度较大,而采购 1-2 仅少量型号产品,数量较少、价格区间跨度较为集中。

具体而言,发行人各期采购 1-1 产品 0 元~1,000 元价格范围产品的实际采购金额占比分别为 60.10%、62.31%、69.83%及 62.30%,占比较大,致使其平均价格较低;发行人各期采购 1-2 产品 0 元~1,000 元价格范围产品的实际采购金额占比分别为 2.41%、18.15%、19.51%及 10.17%,占比较低,致使其平均价格较高。

C.发行人采购产品线 1-1 中也存在相当型号数量的价格高于产品线 1-2,且 相关产品的采购金额远大于采购产品线 1-2 的金额

根据统计,1-1 产品也存在很多型号的实际采购价格高于 1-2 产品:报告期各期,发行人采购 1-1 产品的 FPGA 芯片分别有 96 个型号的实际采购价格(均价为 35,326.98 元)高于 1-2 的 4,634.36 元、214 个型号的实际采购价格(均价为 19,084.33 元)高于 1-2 的 959.86 元、213 个型号的实际采购价格(均价为 30,854.25 元)高于 1-2 的 822.82 元、185 个型号的实际采购价格(均价为 20,434.10 元)高于 1-2 的 500.48 元。

报告期各期,1-2产品的总实际采购金额、1-1产品高于1-2均价的型号实际采购金额具体如下表所示:

单价:万元

项目	2023 年 1-6 月	2022年	2021年	2020年
产品 1-2 的总实际采购金额	4,336.28	11,514.28	9,688.00	1,795.81
产品 1-1 当期高于产品线 1-2 均价的型号的实际采购金额	24,986.04	55,672.47	55,884.58	9,603.24

综上所述,FPGA产品中存在返利的产品主要是1-1、1-2,原厂供应商均为国际知名芯片大厂,与发行人之间不存在关联关系。发行人按照原厂制定的统一目录价格进行采购,并按照原厂制定的严格流程进行返利申报,虽然相关供应商的返利比例及实际结算价格存在差异,但主要是供应商自身的销售定价策略、应用领域、产品功能/性能等差异所致,实际采购价格具有公允性。

(2) ASIC

报告期内,ASIC 中存在返利供应商的实际采购金额占当期 ASIC 总实际采购金额的比例分别为 76.64%、83.87%、91.97%、84.09%,其中主要供应商(如下表所示)的实际采购金额占当期 ASIC 芯片总实际采购金额的比例分别为 76.29%、81.03%、81.40%、74.21%,该等主要供应商的返利比例、扣除产品返利后的实际采购单价的对比情况如下表所示:

单位: 元/颗

序号	供应商	返利比例	实际平均采购单价
2023年1-6月			
1	供应商 1-3	5.36%	22.08

序号	供应商	返利比例	实际平均采购单价
2	供应商 1-4	40.47%	790.53
3	供应商 1-5	28.37%	9.92
4	供应商 1-6	47.50%	5.83
5	供应商 1-7	54.26%	3.88
		2022年度	
1	供应商 1-4	45.83%	547.77
2	供应商 1-5	7.03%	16.99
3	供应商 1-3	7.21%	19.03
4	供应商 1-2	9.57%	86.92
5	供应商 1-8	39.01%	5.41
		2021年度	
1	供应商 1-5	3.01%	17.65
2	供应商 1-4	35.26%	450.85
3	供应商 1-2	9.70%	99.31
4	供应商 1-7	23.71%	5.54
5	供应商 1-3	50.44%	2.71
		2020年度	
1	供应商 1-5	1.63%	19.17
2	供应商 1-3	59.71%	2.31
3	供应商 1-6	3.96%	4.87
4	供应商 1-9	24.93%	0.42
5	供应商 1-10	33.66%	0.87

关于返利比例,因为各原厂供应商之间面临的竞争市场、产品定位、销售定价策略等存在差异,主要供应商在报告期内返利比例存在一定差异,各供应商在报告期内的返利比例也存在一定的波动。在ASIC产品中,供应商1-4/1-8、1-9、1-10、1-7返利比例较高,供应商1-2、1-5返利比例较低,各产品线之间的返利比例不具有可比性。

关于实际采购价格,因为各产品线主要应用领域、产品功能/性能存在差异,使得发行人对各供应商的实际采购价格存在差异。以上述主要产线进行说明:产品线1-3主要为声卡、音频芯片,主要功能为物联网控制、语音、影像等;产品线1-8/产品线1-4主要为智能网卡,主要功能为以太网适配器;产品线1-5主要为

无线通信芯片,主要功能为无线音频传输;产品线1-6产品线主要以太网芯片,主要功能为以太网信号收发等;产品线1-7主要为射频接收器芯片,主要功能为数据转换,实现信号的转接;产品线1-2主要为物联网处理器芯片,主要功能为处理来自传感器的原始数据,形成视觉信号;产品线1-9主要为电路保护芯片,主要功能包括静电防护、电路保护、高低速转换接口等;产品线1-10主要为电源管理芯片,主要功能为充放电管理、电源控制、连接器等。

综上所述,ASIC产品中存在返利的供应商主要是1-3、1-8(含1-4)、1-5、1-6、1-7、1-2、1-9、1-10,原厂供应商均为国际知名芯片大厂,与发行人之间不存在关联关系。发行人按照原厂制定的统一目录价格进行采购,并按照原厂制定的严格流程进行返利申报,虽然相关供应商的返利比例及实际结算价格存在差异,但主要是供应商自身的销售定价策略、应用领域、产品功能/性能等差异所致,实际采购价格具有公允性。

(3) 处理器芯片

报告期内,处理器芯片中存在返利供应商的实际采购金额占当期处理器芯片总实际采购金额的比例分别为 34.89%、71.47%、72.04%、75.99%, 其中主要供应商(如下表所示)的实际采购金额占当期处理器芯片总实际采购金额的比例占比分别为 34.89%、71.44%、71.75%、74.75%, 该等主要供应商的返利比例、扣除产品返利后的实际采购单价的对比情况如下表所示:

单位:元/颗

序号	供应商	返利比例	实际平均采购单价		
	2023年1-6月				
1	供应商 1-2	36.11%	897.00		
2	供应商 1-6	49.29%	7.81		
3	供应商 1-7	19.94%	72.17		
4	供应商 1-11	46.58%	9.35		
5	供应商 1-12	3.02%	11.42		
		2022年度			
1	供应商 1-2	31.65%	606.18		
2	供应商 1-13	0.64%	404.15		
3	供应商 1-6	49.44%	5.65		

序号	供应商	返利比例	实际平均采购单价
4	供应商 1-7	29.56%	69.51
5	供应商 1-11	39.13%	4.97
		2021年度	
1	供应商 1-2	23.29%	755.06
2	供应商 1-7	3.97%	84.76
3	供应商 1-6	54.93%	5.18
4	供应商 1-11	41.16%	4.17
5	供应商 1-13	6.73%	2,276.48
		2020年度	
1	供应商 1-11	51.37%	4.46
2	供应商 1-6	57.93%	5.14

注 1: 2020 年, 处理器芯片采购金额中存在包括返利情况的供应商仅有 2 家。

关于返利比例,因为各原厂供应商之间面临的竞争市场、产品定位、销售定价策略等存在差异,主要供应商在报告期内返利比例存在一定差异,各供应商在报告期内的返利比例也存在一定的波动。在处理器芯片产品中,供应商 1-6、1-11 的返利比例均较高,供应商 1-2、1-7 的返利比例居中,供应商 1-13、1-12 的返利比例均较低,各产品线之间的返利比例不具有可比性。

关于实际采购价格,因为各产品线主要应用领域、产品功能/性能存在差异,使得发行人对各供应商的实际采购价格存在差异。以上述主要产线进行说明:产品线 1-2 主要为 CPU 处理器,面向 PC、服务器和人工智能等下游应用场景;产品线 1-6 主要为微处理器,应用于工业控制和自动化、医疗设备和健康科技、通信和网络等场景;产品线 1-11 主要为微处理器,应用于 ICE 动力总成、底盘和安全性、车身和便利性设备、高级驾驶辅助系统(ADAS)等场景;产品线 1-7 主要为微处理器产品,可应用于电源电压监测、监控电路等场景;产品线 1-12 主要为手机微处理器、控制器芯片,可应用于智能手机、移动设备等场景;产品线 1-13 主要为集成度较高的多核高频处理器芯片,面向笔记本电脑、服务器、游戏主机等下游应用场景。

综上所述,处理器芯片产品中存在返利的供应商主要是供应商 1-2、1-6、1-11、1-7、1-12、1-13 等,原厂供应商均为国际知名芯片大厂,与发行人之间不存在关联关系。发行人按照原厂制定的统一目录价格进行采购,并按照原厂制定的严

格流程进行返利申报,虽然相关供应商的返利比例及实际结算价格存在差异,但 主要是供应商自身的销售定价策略、应用领域、产品功能/性能等差异所致,实 际采购价格具有公允性。

(4) 存储芯片

报告期内,存储芯片中存在返利供应商的实际采购金额占当期存储芯片总实际采购金额的比例分别为 79.45%、80.74%、66.00%、13.42%, 其中主要供应商(如下表所示)的实际采购金额占当期存储芯片总实际采购金额的比例分别为79.45%、80.74%、65.98%、13.19%, 该等主要供应商的返利比例、扣除产品返利后的实际采购单价的对比情况如下表所示:

单位:元/颗

序号	供应商	返利比例	实际平均采购单价			
	2023年1-6月					
1	供应商 1-14	59.17%	7.54			
2	供应商 1-15	49.87%	15.48			
3	供应商 1-6	64.98%	0.71			
4	供应商 1-1 ¹	86.68%	192.49			
5	供应商 1-16	0.57%	2.73			
		2022年度				
1	供应商 1-14	32.57%	33.48			
2	供应商 1-15	57.34%	36.06			
3	供应商 1-1	83.58%	94.65			
4	供应商 1-6	65.64%	0.91			
5	供应商 1-11	27.39%	0.81			
		2021 年度				
1	供应商 1-15	46.51%	55.28			
2	供应商 1-14	41.04%	29.84			
3	供应商 1-1	78.34%	76.54			
4	供应商 1-6	63.23%	0.71			
5	供应商 1-11	36.43%	1.08			
		2020 年度				
1	供应商 1-15	25.95%	31.80			
2	供应商 1-14	43.70%	14.42			

序号	供应商	返利比例	实际平均采购单价
3	供应商 1-1	65.72%	62.67
4	供应商 1-6	67.97%	0.58
5	供应商 1-11	31.68%	0.85

注 1: 供应商 1-1 销售少量配置自身 FPGA 产品使用的可编程存储器。

关于返利比例,因为各原厂供应商之间面临的竞争市场、产品定位、销售定价策略等存在差异,主要供应商在报告期内返利比例存在一定差异,各供应商在报告期内的返利比例也存在一定的波动。在存储芯片产品中,供应商 1-14、1-6、1-15 返利比例均较高,供应商 1-11 返利比例居中,供应商 1-16 的返利比例相对较低,各产品线之间的返利比例不具有可比性。

关于实际采购价格,因为各产品线主要应用领域、产品功能/性能存在差异,使得发行人对各供应商的实际采购价格存在差异。以上述主要产线进行说明:产品线 1-14 主要为较高端的内存产品,主要应用于前沿计算、网络和移动便携产品等场景;产品线 1-6 主要为非易失性存储产品、带电可擦可编程只读存储器产品,主要应用于高性能的计算设备和需要快速数据访问的场景中,如处理器缓存、高速缓存、图形处理器等;产品线 1-1 主要为可编程存储器,主要应用于搭配其FPGA产品使用;产品线 1-15 主要为闪存卡,主要应用于工业领域存储、消费电子等场景;产品线 1-11 主要为 RFID 应答器,主要应用于交通管理、收费站等场景;产品线 1-16 主要为闪存存储器和存储 IC 产品,主要应用于信息通信、智能穿戴设备等场景。

综上所述,存储芯片产品中存在返利的产品线主要是供应商1-14、1-6、1-16、1-11、1-15、1-1,原厂供应商均为国际知名芯片大厂,与发行人之间不存在关联关系。发行人按照原厂制定的统一目录价格进行采购,并按照原厂制定的严格流程进行返利申报,虽然相关供应商的返利比例及实际结算价格存在差异,但主要是供应商自身的销售定价策略、应用领域、产品功能/性能等差异所致,实际采购价格具有公允性。

(5) 模拟芯片

报告期内,模拟芯片中存在返利供应商的实际采购金额占当期模拟芯片总实际采购金额的比例分别为66.36%、62.78%、68.72%、70.85%,其中主要供应商

(如下表所示)的实际采购金额占当期模拟芯片总实际采购金额的比例分别为59.98%、55.87%、59.28%、62.94%,该等主要供应商的返利比例、扣除产品返利后的实际采购单价的对比情况如下表所示:

单位:元/颗

بد	مادر الم	Spenings to to the to	单位:元/颗				
序号	供应商	返利比例	实际平均采购单价				
	2023年1-6月						
1	产品线 1-17	0.61%	0.43				
2	产品线 1-5	13.85%	4.11				
3	产品线 1-10	31.60%	0.65				
4	产品线 1-18	0.50%	26.49				
5	产品线 1-11	45.59%	3.19				
	2	2022年度					
1	产品线 1-17	2.17%	0.58				
2	产品线 1-5	12.17%	3.08				
3	产品线 1-8	0.01%	27.89				
4	产品线 1-10	20.10%	0.61				
5	产品线 1-7	46.93%	24.43				
	2	2021年度					
1	产品线 1-5	3.20%	2.67				
2	产品线 1-17	1.54%	0.40				
3	产品线 1-18	0.01%	18.94				
4	产品线 1-10	23.61%	0.46				
5	产品线 1-4	32.90%	1,891.02				
	2	2020年度					
1	产品线 1-5	0.38%	0.45				
2	产品线 1-17	1.95%	3.23				
3	产品线 1-18	0.02%	14.37				
4	产品线 1-19	7.89%	1.00				
5	产品线 1-10	29.02%	0.34				

关于返利比例,因为各原厂供应商之间面临的竞争市场、产品定位、销售定价策略等存在差异,主要供应商在报告期内返利比例存在一定差异,各供应商在报告期内的返利比例也存在一定的波动。在模拟芯片产品中,供应商 1-10、1-11、1-4、1-7 的返利比例均较高,供应商 1-17、1-5、1-19、1-18 的返利比例较低,

各产品线之间的返利比例不具有可比性。

关于实际采购价格,因为各产品线主要应用领域、产品功能/性能存在差异,使得发行人对各供应商的实际采购价格存在差异。以上述主要产线进行说明:产品线 1-10 主要为放大器、DC/DC 转换器芯片,主要应用于信号链和电源管理等场景;产品线 1-11 主要为速度传感器、光敏传感器、震动传感器芯片,主要应用于汽车电子、安防监控、航空航天等场景;产品线 1-16 主要为模拟数字转换、模拟比较电路芯片,主要应用于工业自动化、医疗设备等场景;产品线 1-14 主要为交换机芯片,主要应用于数据传输和交换等场景;产品线 1-7 主要为 RF 接收器和射频接收器片上系统(SoC)等,主要用于电视、宽带、信号收发等场景;产品线 1-17 主要为 LED 芯片、红外发射管、光电二极管、光电三极管等产品,主要应用于照明、光学技术等场景;产品线 1-5 主要为低噪声晶体管、线性放大器、衰减器、循环器、隔离器等产品,主要应用于电子产品、移动设备、智能能源等场景;产品线 1-19 主要为射频前端晶片器件,主要应用于无线路由器、个人电脑、可穿戴设备等的无线连接场景;产品线 1-18 主要为 WIFI 模块、蓝牙模块等,主要应用于无线路由器、蓝牙、移动设备等的无线连接场景。

综上所述,模拟芯片产品中存在返利的产品线主要是供应商1-17、1-5、1-10、1-11、1-7、1-4、1-19、1-18,原厂供应商均为国际知名芯片大厂,与发行人之间不存在关联关系。发行人按照原厂制定的统一目录价格进行采购,并按照原厂制定的严格流程进行返利申报,虽然相关供应商的返利比例及实际结算价格存在差异,但主要是供应商自身的销售定价策略、应用领域、产品功能/性能等差异所致,实际采购价格具有公允性。

二、结合各类产品供应商采购返利比例情况、存在差异的原因及合理性分析等,进一步说明赛灵思等供应商返利比例较高的原因及合理性,相关返利的 真实性

各类产品供应商采购返利比例情况、存在差异的原因及合理性分析等请参见本题之一/(二)所述。

结合上述分析, 赛灵思采取高目录价、高返利的原因主要包括:

1、Xilinx 的 FPGA 芯片产品具有独特的技术优势,但在大多数应用领域需

求量不大

Xilinx 的 FPGA 芯片产品具有较强功能及性能,在全球市场均具备较强的产品竞争力,可应用于 5G 通信、数据中心、尖端工业、高端医疗设备、精密测量仪器、汽车电子等前沿科技领域,但在大多数应用领域对 Xilinx 产品的需求量不大。原厂以较高的目录价格进行定价,并高返利比例可以作为激励措施,鼓励分销商更积极地推广和销售其产品。

2、高目录价、高返利的定价策略有助于为 Xilinx 争取市场份额、保持竞争 优势

Xilinx 通过高目录价、高返利的策略来增加市场份额并保持竞争优势。Xilinx 通过给予分销商较高的返利,可以鼓励分销商专注于销售其产品而非竞争对手的产品,从而实现市场份额的增长、保持竞争优势。

3、高目录价、高返利的定价策略有助于为 Xilinx 把控渠道并保持安全的市场定位

Xilinx 通过高目录价、高返利的模式来保证其产品的流通渠道和安全的市场定位。通过选择高返利比例的分销策略,Xilinx 可以尽量确保产品主要通过合作的授权分销商销售,限制非授权渠道销售,并维护产品的形象和定位。

综上所述,Xilinx 采取高目录价、高返利的分销模式主要取决于其销售策略等综合考虑,具备合理性。

经保荐人、申报会计师核查了返利凭证、对 Xilinx 发送返利函证、并访谈了 Xilinx 相关负责人员, Xilinx 对发行人的返利具备真实性。

- 三、结合与赛灵思等主要供应商的合作协议以及续约条件、历史上更换供应商的频率、相关国际贸易政策变化以及对发行人审计情况、审计结论等进一步论证双方合作的可持续性,返利政策的稳定性;发行人针对供应商的合规性政策、国际贸易政策的内控措施及有效性,是否存在影响持续经营能力的相关风险;就上述事项在招股说明书"重大事项提示"部分补充提示相关风险
- (一)结合与赛灵思等主要供应商的合作协议以及续约条件、历史上更换 供应商的频率、相关国际贸易政策变化以及对发行人审计情况、审计结论等进 一步论证双方合作的可持续性,返利政策的稳定性

通过多年的行业深耕,发行人与我国本土大量的创新创业企业客户群建立了紧密的联系,积累了丰富的行业经验和本土化的服务能力,树立了较高的品牌价值和良好的企业形象,构筑了较高的竞争壁垒。对于海外原厂而言,与发行人保持商业合作关系是"双赢"的选择。若原厂更换发行人分销商的角色,原厂需要承担替换分销商所带来的较大不确定性,会给原厂带来较大的运营风险。

以下结合发行人与赛灵思等主要供应商的合作协议以及续约条件、历史上更 换供应商的频率、相关国际贸易政策变化以及对发行人审计情况、审计结论等进 一步论证双方合作的可持续性:

1、主要供应商的合作协议以及续约条件

凭借过硬的技术实力、深度的市场开拓能力及全方位的服务能力,发行人已成为多个原厂供应商在中国本土市场的优秀商业合作伙伴,多年来与赛灵思等主要供应商形成了良好稳定、互惠互利的商业伙伴关系,相关供应商均有较强意愿与发行人继续保持或加强合作,在取得授权续期方面不存在重大不确定性。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司与赛灵思等主要供应商签署的合作协议以及续约条件等主要情况如下表所示:

序号	供应商名称	取得授权时间	续约条件	履行情况
1	Xilinx	2010年	本协议自生效之日(2010年2月25日)起一年内有效,除非根据本协议条款提前终止。在协议有效期届满时,本协议将自动续期,除非一方在本协议到期前至少60天向另一方发出书面通知	正在履行

序号	供应商名称	取得授权时间	续约条件	履行情况
2	Intel	2014年	本协议自签署之日(2014.11.01)起至同年 12 月 31 日有效。有效期届满后,本协议将 自动续期,除非任何一方提前 30 天提出异议	正在履行
3	Microchip	2009年	本协议为永久生效协议,在 2019 年 1 月 1日 ^{±1} 开始生效,除非发生本协议规定的终止情形	正在履行
4	MaxLinear	2020年	代理协议自生效日(2020年7月1日)开始 持续一年,自动续签一年,此后可再续签两 年	正在履行
5	ST	2018年	本协议应自生效之日(2018年1月1日)起一年内继续完全有效,有效期届满后,本协议将自动续期,除非发生本协议规定的终止情形	正在履行
6	Sandisk	2018年	协议有效期为 2018.07.27 至 2022.07.26。有效期届满后,本协议将自动续期,除非任何一方提前 30 天提出异议	正在履行
7	NVIDIA/Mel lanox	2017年	NVIDIA 产品线代理协议的续约条款为,除非根据本协议规定提前终止,否则本协议应自生效之日(2022 年 6 月 14 日)起一年内继续完全有效。有效期届满后,本协议将自动续期,除非任何一方在当前期限到期前至少三十(30)天发出书面终止通知发行人最初取得 Mellanox 授权时间为 2017年, Mellanox 被 NVIDIA 收购后,发行人与NVIDIA 重新签订了 Mellanox 产品线的代理协议,续约条款为,本协议自生效之日(2022 年 5 月 25 日)起至一年内保持有效。有效期届满后,本协议将自动续期,除非任何一方根据约定送达终止通知或提前终止	正在履行

注 1: 发行人最初取得 Microchip 产线的授权时间为 2009 年,最新授权协议的签署时间为 2019 年。

如上表所示,发行人与赛灵思等主要供应商均签署了授权分销协议,发行人与上述供应商保持了良好的商业合作关系,报告期内上述授权分销协议均系自动续期或顺利续期,不存在终止授权的情况,发行人在取得主要供应商授权续期方面不存在重大不确定性,与主要供应商之间的合作关系稳定且可持续。

2、历史上更换供应商的频率

报告期内,赛灵思等主要供应商未曾更换发行人作为授权分销商的角色。授权分销商的市场拓展是原厂延伸销售的重要方式,芯片销售具有较高的复杂性,此种复杂性既来源于芯片产品本身的技术复杂、应用复杂,也来源于下游应用市场的广泛性和多变性,授权分销商通常需要介入下游客户的立项、研发、产品定

型、批量生产、售后服务等整个生命周期。同时,在芯片销售的过程中还牵涉到大量的订单管理、库存管理、物流、资金结算等环节,授权分销商需要建立强大的信息系统以支撑这些业务需求。因此,授权分销商需要具备对原厂的全方位支持能力,具有较高的门槛要求。原厂供应商为了维护自身业务的稳定性和业务的可持续发展,除非分销商发生了较大的风险事件或自身业务能力持续下降至不满足要求等极端情况,原厂一般不会轻易更换分销商,尤其是主要的授权分销商。

此外,由于原厂供应商、授权分销商、终端客户之间构建的是长期合作模式,在分销模式正常运行的情况下,客户一般不会主动要求原厂更换分销商,原厂一般也不会同意更换分销商,客户与分销商之间的合作问题一般由双方协商解决。

再者,发行人不存在因不满足供应商授权认证的条件、程序而导致到期未取得授权的情形。但存在基于业务规划调整,包括 Senslab、Diotec 等在内的七条产线在到期后未进行续期的情形。发行人向上述相关原厂采购金额较小,报告期各期分别为 52.36 万元、45.48 万元、13.45 万元和 0 万元。报告期内,发行人与赛灵思等主要供应商保持稳定合作关系。

综上所述,发行人通过多年的行业深耕,与我国本土大量的创新创业企业客户群建立了紧密的联系,积累了丰富的行业经验和本土化的服务能力,树立了较高的品牌价值和良好的企业形象,构筑了较高的竞争壁垒。报告期内,发行人未曾出现风险事件、不存在自身业务能力持续下降至不满足要求或被终端客户要求更换授权分销商的情况,赛灵思等主要供应商未曾更换发行人作为授权分销商的角色,与赛灵思等主要供应商保持稳定合作关系。

3、相关国际贸易政策变化

近年来,部分国家通过贸易保护的手段接连出台一系列政策限制我国半导体产业发展。2019年5月,美国商务部将若干我国公司列入"出口管制实体清单"; 2020年5月,美国商务部修订直接产品规则(Foreign-Produced Direct Product Rule),进一步限制我国部分公司获取半导体技术和服务的范围; 2020年7月,美国商务部宣布取消对我国香港的特殊相关待遇,包括暂停出口许可证豁免; 2022年10月,美国商务部宣布修订《出口管理条例》,限制我国发展先进工艺半导体和进口AI芯片,同时限制其国人参与我国先进半导体研发; 2023年9月,

美国商务部发布《芯片和科学法案》,限制了其国家的芯片基金受助人十年内在我国扩大半导体材料生产能力,同时也限制了受助人在我国开展联合研究或技术许可活动; 2023 年 10 月,美国宣布出台一系列新的限制措施,包括限制高性能计算芯片(如 NVIDIAA800 和 H800 GPU 芯片等)向我国出口、对我国半导体设备的限制进一步升级、将我国壁仞科技及摩尔线程等 13 家企列入实体清单。自从 2019 年来美国对中国半导体产业的限制政策日益增多,并且越来越具体、力度也越来越大。

目前,该等政策对发行人业务的影响主要是发行人不可以向被列入限制清单的客户销售某类被限制的芯片产品、不可以在被限制国家/地区销售某类被限制的产品。发行人主要服务我国中小企业客户,客户群体广,基本不属于国际贸易政策限制的实体清单企业,发行人亦未采购或销售被限制的产品,对发行人的影响较小。报告期内,发行人严格遵守此等国际贸易管制政策的要求,此等贸易摩擦仅影响发行人与个别客户的合作情况,对发行人影响较小,其余客户未受到影响,亦未影响发行人与供应商的合作代理情况。

此外,发行人的销售活动均是在满足原厂的合规审查要求并获得原厂同意的情况下进行,报告期内发行人不存在因违反相关国家出口管制条例而出现断供的情形,也未出现合规审查不通过而终止授权代理协议的情况。

但是,若未来国际贸易摩擦加剧,公司可能因国际贸易管制措施无法采购部 分国外原厂产品,或无法及时采购进口电子元器件,或因下游客户受国际贸易摩 擦影响导致产能需求下降,从而对公司的经营业绩产生不利影响。

4、对发行人审计情况、审计结论

2019年至今,发行人共接受11次供应商审计,具体情况如下:

序号	供应商名称	审计时间	审计结果	审计内容
1	供应商 1-1	2022年	无异常	库存盘点
2	供应商 1-2	2021年	无异常	1、审计当天的芯片库存数;2、系统整年发货数据核查
3	供应商 1-3	2020年	无异常	财务和业务审计
4	供应商 1-4	2021年	无异常	2021年度销售额及在途订单的客户项目情况
5	供应商 1-5	2021年	无异常	审查分销商的销售区域是否合规
6	供应商 1-6	2022年	无异常	分销质量审计

序号	供应商名称	审计时间	审计结果	审计内容
7	供应商 1-7	2019年	无异常	库存盘点
8	供应商 1-8	2021年	无异常	临时性合规核查,库存数据统计
9	供应商 1-9	2019年	无异常	1、库存盘点; 2、系统整年发货数据核查
10	供应商 1-10	2021年	无异常	审查分销商的销售区域是否合规
11	供应商 1-11	2020年	无异常	库存盘点

发行人严格遵守供应商审计政策,报告期内未收到任何原厂关于审计不合规或取消授权合作的通知,未曾影响发行人与供应商合作的持续性。

5、返利政策的稳定性

(1) 返利政策、内控流程具备稳定性

核心芯片原厂出于对其芯片产品的全球定位和价格管理需求,对授权分销商采取返利的销售模式,即分销商按照全球统一出厂价向原厂采购芯片,当向下游销售后,原厂再给予分销商返利,政策内容、内控流程具备稳定性,该政策与供应商续约条件、历史上更换供应商的频率、国际贸易政策变化或原厂对发行人的审计情况、审计结论等不存在直接相关关系。同行业可比公司中电港、好上好、商络电子、润欣科技等公司均存在稳定的供应商返利政策。

(2)返利比例高低主要取决于供应商的定价策略,不影响发行人的正常经 营及合理盈利

原厂供应商结合产品定位及销售策略、产品竞争态势、终端客户应用领域、产品功能/性能等多重因素审批决定产品的实际采购价格,进而确定返利金额/比例。同类产品的不同产线返利可能存在差异,同一产线的返利也可能存在一定波动,但不影响发行人的经营及盈利。从发行人申报返利的内控流程来看,发行人系经原厂供应商审批并知悉了预提返利金额后才向终端客户销售,故发行人不存在不能获取返利的风险;其次,返利比例主要取决于供应商的定价策略,但不会影响发行人获取正常的毛利率。因此,返利比例高低主要取决于供应商的定价策略,但无论其高低,不会影响发行人的正常经营或获取合理盈利。

综上所述,原厂供应商的返利政策具备稳定性。

(二)发行人针对供应商的合规性政策、国际贸易政策的内控措施及有效 性,是否存在影响持续经营能力的相关风险

发行人所处的行业主要受相关国家出口管制条例、实体清单等政策约束。发行人针对供应商的合规审计政策、国际贸易政策,制定了合理的内控措施。

1、发行人制定了向原厂报备最终客户的内控措施,确保发行人及原厂均符 合出口管制条例等的要求,影响发行人持续经营能力的相关风险较低

发行人根据与原厂授权协议的约定,向原厂报备最终客户信息,确保发行人及原厂均符合相关国家出口管制条例的要求。在报备客户信息前,发行人按照原厂制定的标准流程执行严格的客户信息核查,以确认符合出口管制条例的要求、不属于实体清单企业、产品用途非军用等。完成客户信息核查后,发行人将客户信息核查报告提交予原厂,在实操过程中,发行人会同时填报交易客户信息及最终客户信息。原厂审核通过并完成客户注册后,发行人开始商业销售活动。因发行人和原厂需要共同遵守相关国家出口管制的要求,若存在发行人单独难以把握的情况,发行人通常与原厂一起进行核查、判断。

发行人持续向原厂报备最终客户交易情况,确保持续满足相关国家出口管制条例的要求。在后续的商业活动中,发行人按照与原厂的协议约定,定期向原厂报备最终客户信息、产品线、产品型号、交易数量等信息,确保商业活动符合合规审查的要求。发行人的销售活动均是在达到原厂的合规审查要求并获得原厂同意的情况下进行。

保荐人、申报会计师核查了发行人向原厂申报返利的网络页面、填报单据、 获取书面确认、对原厂进行访谈,原厂知晓发行人的交易客户信息及最终客户信息,发行人报备客户信息的方式符合原厂规则、向原厂报备客户信息与实际销售 对象一致,影响发行人持续经营能力的相关风险较低。

2、发行人制定了严格的供应商审计内控政策,确保发行人符合出口管制条例的要求,影响发行人持续经营能力的相关风险较低

原厂会通过独立审查程序确保发行人符合出口管制条例的要求。原厂会定期 /不定期独立委派专业人员或外部机构对发行人执行合规审查,若存在合规审查 不通过的情况,将终止与发行人的授权代理协议。发行人制定了严格的供应商审 计内控政策,报告期内均顺利完成原厂的各项合规审查,未出现合规审查不通过 而终止授权代理协议的情况,影响发行人持续经营能力的相关风险较低。

综上,发行人的销售活动均是在达到原厂的合规审查要求并获得原厂同意的情况下进行,报告期内发行人不存在因违反相关国家出口管制条例而出现断供的情形,也未收到任何原厂关于合规审查不通过的通知,报告期内相关内控措施得到有效执行,影响发行人持续经营能力的相关风险较低。

(三) 就上述事项在招股说明书"重大事项提示"部分补充提示相关风险

发行人已在《招股说明书》/"第二节 概览"/"一、重大事项提示"中补充 披露相关风险:

"2、供应商合规性政策风险

原厂供应商会定期/不定期独立委派专业人员或外部机构对授权分销商的分销活动和返款申报情况进行检查,若检查发现分销商存在不符合出口管制政策、返款申报不符合原厂政策的情况,可能存在终止与发行人的授权代理协议或无法足额收到返利的风险。发行人制定了严格的供应商审计内控、返利申报内控政策,报告期内均顺利完成原厂的各项合规审查,未出现合规审查不通过而终止授权代理协议或未足额收到返利的情况。

若后续因发行人内控管理失效,未能通过原厂的各项合规审查,相关原厂可能会终止对发行人的产品线授权、不足额支付返利,从而对公司的经营业绩产生不利影响。

3、国际贸易摩擦风险

近年来,国际贸易摩擦不断,全球半导体产业格局进入深度调整期,部分国家出台了一系列措施,限制我国部分实体企业购买先进芯片产品或获取先进芯片制造技术。当下,我国仍然面临着部分高端电子元器件领域的关键技术被海外厂商所垄断的不利局面。因此我国半导体产业在供应链稳定及国际贸易环节,仍将持续面临来自国际贸易摩擦的持续挑战。

报告期内,发行人授权分销业务代理的国际产品线占主营业务收入比例较高, 主要包括 Xilinx、Skyworks、Intel、Nvidia、SanDisk、Microchip、Osram 等国际 原厂。若未来国际贸易摩擦加剧,公司可能因国际贸易管制措施无法采购部分国外原厂产品,或无法及时采购进口电子元器件,或因下游客户受国际贸易摩擦影响导致产能需求下降,从而对公司的经营业绩产生不利影响。

此外,根据与原厂授权协议的约定,发行人需向原厂报备最终客户信息,确保发行人及原厂均符合相关国家出口管制条例的要求。若后续因发行人内控管理失效,出现不符合出口管制条例要求的情况,相关原厂可能会终止对发行人的产品线授权,从而对公司的经营业绩产生不利影响。"

四、中介机构核查程序与核查意见

(一) 核査程序

- 1、核查发行人收入成本表,对存在返利的产品进行统计分析;
- 2、核查发行人采购表,对存在返利的产品模拟计算其实际采购金额、返利 比例、采购价格等指标:
- 3、访谈发行人主要产线的采购负责人,了解发行人主要返利政策和内部控制制度:
 - 4、对主要返利产线执行穿行测试,判断内控的有效性:
- 5、对主要供应商进行访谈,验证发行人返利的真实性,核查比例超过各期 采购额的80%;
- 6、获取报告期内发行人全部的返利文件,并对所有发放返利的供应商进行 函证,报告期各期回函确认金额均超过了95%,确认了返利的准确性;
- 7、对返利进行期后测试,核查期末应收返利余额的期后收回情况,期后核查显示期末应收返利余额基本能在两周左右收回;
- 8、获取发行人与主要供应商的授权代理协议,核查包括授权内容、续约条件等在内的主要协议内容;
- 9、访谈发行人业务负责人,了解并分析发行人针对供应商的合规审计政策、 国际贸易政策所制定内控措施的合理性、执行的有效性;
 - 10、通过公开信息检索国际贸易政策变化情况,分析对发行人的影响。

(二)核査意见

- 1、(1)发行人已说明报告期内 FPGA、ASIC、处理器芯片、模拟芯片、存储芯片等主要产品中存在返利产品的采购金额及占比情况、扣除返利后采购金额及占比情况、相关供应商情况; (2)原厂供应商均为国际知名芯片大厂,与发行人之间不存在关联关系,发行人按照原厂制定的统一目录价格进行采购,并按照原厂制定的严格流程进行返利申报,虽然相关供应商的返利比例及实际结算价格存在差异,但主要是供应商自身的销售定价策略、应用领域、产品功能/性能等差异所致,实际采购价格具有公允性。
- 2、发行人已结合各类产品供应商采购返利比例情况、存在差异的原因及合理性分析等,进一步说明了赛灵思等供应商返利比例较高的原因及合理性,相关返利具备真实性。
- 3、(1)发行人与我国本土大量的创新创业企业客户群建立了紧密的联系,积累了丰富的行业经验和本土化的服务能力,树立了较高的品牌价值和良好的企业形象,构筑了较高的竞争壁垒。对于海外原厂而言,与发行人保持商业合作关系是"双赢"的选择。若原厂更换发行人分销商的角色,原厂需要承担替换分销商所带来的较大不确定性,会给原厂带来较大的运营风险。发行人与赛灵思等主要供应商均签署了授权分销协议,发行人与上述供应商保持了良好的商业合作关系,报告期内上述授权分销协议均系自动续期或顺利续期,不存在终止授权的情况,发行人在取得主要供应商授权续期方面不存在重大不确定性;发行人严格遵守国际贸易政策的要求,报告期内该等政策对发行人影响较小;发行人严格遵守供应商审计政策,报告期内未收到任何原厂关于审计不合规或取消合作的通知。因此,发行人与主要供应商的合作具有可持续性,并且返利政策具有稳定性;(2)发行人针对供应商的合规审计政策、国际贸易政策,制定了合理健全的内控措施,报告期内相关内控措施得到有效执行,影响发行人持续经营能力的风险较低;(3)发行人已就上述事项在招股说明书"重大事项提示"部分补充提示相关风险。

问题 2. 关于期后业绩与存货

申报材料及审核问询回复显示:

- (1)报告期内,发行人营业收入分别为 422, 149.08 万元、 762, 083.82 万元、807, 423.63 万元, 扣非后归母净利润分别为 15, 705.83 万元、30, 919.98 万元、30, 751.58 万元。审阅报告显示,2023 年上半年,发行人营业收入同比下滑14.23%、扣非后归母净利润同比下滑27.03%,主要系2023 年宏观经济整体下行,电子元器件终端需求较为疲软等原因所致。
- (2)报告期各期末,发行人存货余额分别为 3.44亿元、21.85亿元、40.14亿元。各期末存货余额增幅较大的主要原因一是受下游产品制造商对于芯片需求 旺盛影响,发行人扩大经营规模,提前备货;二是 2021年、2022年末发行人新增存货中包含的预估返利较多。审阅报告显示,2023年上半年末,发行人存货余额 49.73亿元,较报告期初增加 23.90%。

请发行人:

- (1)结合芯片分销行业景气度及竞争状况、产品终端应用领域需求具体变化、发行人毛利率、客户变动以及变动原因等情况详细说明 2023 年上半年业绩存在下滑的原因,与行业整体趋势、同行业可比公司对比情况,未来经营业绩是否存在进一步下滑风险。
- (2)说明 2022 年末、2023 年上半年末存货构成、包含预估返利的存货金额及占比情况、库龄、期后结转情况、2023 年上半年末订单覆盖率;在 2022 年营业收入增速放缓、2023 年上半年营业收入存在下滑情况下,2022 年末、2023 年上半年末存货余额持续大幅增长的原因,发行人存货是否存在大额滞销、退换货的情形;结合 2022 年末、2023 年上半年末存货减值测试方式与具体过程等进一步说明发行人计提存货跌价准备的充分性。

请保荐人、申报会计师发表明确意见。

回复:

- 一、结合芯片分销行业景气度及竞争状况、产品终端应用领域需求具体变化、发行人毛利率、客户变动以及变动原因等情况详细说明 2023 年上半年业绩存在下滑的原因,与行业整体趋势、同行业可比公司对比情况,未来经营业绩是否存在进一步下滑风险
- (一)结合芯片分销行业景气度及竞争状况、产品终端应用领域需求具体变化、发行人毛利率、客户变动以及变动原因等情况详细说明 2023 年上半年业绩存在下滑的原因
- 1、2023 年上半年半导体行业仍处于去库存的低迷周期,下游市场需求疲软, 使得发行人 2023 年上半年业绩下滑

2023年上半年,半导体行业仍处于去库存的低迷周期,下游市场需求疲软。根据半导体行业协会(SIA)的报道,2023年一季度全球半导体销售额为1,195亿美元,同去年同期相比下降了21.3%;第二季度全球半导体销售总额为1,245亿美元,同比亦下降17.3%。

芯片分销行业作为连接上游"芯片设计与生产"和下游"终端客户制造"的桥梁,其景气程度与半导体行业整体景气程度密切相关。受终端客户需求疲软、去库存等的影响,全球各大芯片分销商在 2023 年上半年业绩均出现不同程度的下滑,如全球规模最大的电子元器件分销商艾睿电子 2022 年全年营收创下历史新高,达到 371.2 亿美元,但 2023 年上半年营收为 172.5 亿美元,较去年同期相比下滑 6.9%;主攻亚洲市场的大联大,2023 年上半年累计营业收入 3,014.43 亿元新台币,较去年同期相比下滑 26.26%;同为分销行业头部企业的文晔科技,2023 年上半年累计营收约 2,376 亿元新台币,较去年同期相比下滑约 8%。

如上所述,2023 年上半年半导体行业仍处于去库存的低迷周期,下游市场 需求疲软,发行人业绩变动情况与行业趋势相同,出现了一定程度的下滑。

2、2023 年上半年境内芯片分销行业竞争格局未出现较大变动,并非造成发 行人业绩变动的主要原因

发行人境内主要竞争对手包括中电港、好上好、深圳华强、商络电子、润欣 科技、雅创电子,境外主要竞争对手包括艾睿电子、安富利、大联大、文晔科技。 根据公开信息,2023 年上半年前述电子元器件分销商未出现影响其行业竞争实 力变动的情况,发行人与其同行业竞争对手的竞争格局未出现较大变动。

根据公开数据,我国 2022 年本土已上市/拟上市前十大的电子元器件分销商在 2023 年上半年的行业排位未出现较大变动,行业竞争格局相对稳定,具体情况如下表所示:

分销商名称	代码	2022 年排名	2023年1-6月排名
中电港	001287.SZ	1	1
深圳华强	000062.SZ	2	2
香农芯创	300475.SZ	3	3
硬蛋创新	0400.HK	4	4
芯智控股	2166.HK	5	5
力源信息	300184.SZ	6	8
好上好	001298.SZ	7	6
商络电子	300975.SZ	8	7
英唐智控	300131.SZ	9	9
云汉芯城	A21701.SZ	10	12

如上所述,2023 年上半年境内芯片分销行业竞争格局未出现较大变动,并 非造成发行人业绩变动的主要原因。

3、2023 年上半年发行人产品在工业互联及数字基建领域的收入下降,致使 发行人同期业绩下滑

2023年1-6月,发行人的主营业务收入按应用领域划分与去年同期变化情况如下:

单位: 万元

公田極極		2022年1-6月		
应用领域	金额	变化金额	变化率	金额
工业互联	153,876.64	-65,582.00	-29.88%	219,458.64
数字基建	86,213.86	-12,342.15	-12.52%	98,556.01
大消费	74,985.62	18827.49	33.53%	56,158.13
智能汽车	32,573.08	1,867.16	6.08%	30,705.92
能源控制	3,004.12	-1,000.28	-24.98%	4,004.40
合计	350,653.33	-58,229.76	-14.24%	408,883.09

发行人主要产品类别涉及的应用领域包括工业互联、数字基建、大消费、智

能汽车、能源控制等领域,2023 年 1-6 月,发行人主营业务收入从去年同期的 408,883.09 万元下降到 350,653.33 万元,下降了 58,229.76 万元,主要系工业互联及数字基建领域的收入下降所致,分别下降了 65,582.00 万元、12,342.15 万元。

工业互联及数字基建的市场需求在持续增长,但由于发行人终端客户的产品需求阶段性得到满足,发行人在工业互联及数字基建领域的收入出现阶段性下降的情况,具体说明如下:

在工业互联领域,中国电子信息产业发展研究院发布的《2022-2023 年中国工业互联网市场研究年度报告》显示,2022 年中国工业互联网市场规模总量达到 8,648 亿元,预计到 2025 年,中国工业互联网市场规模达到 12,688 亿元,预测复合增长率为 13.8%;在数字基建领域,IDC 数据显示,我国智慧城市相关投资年均复合增长率在 2022 年至 2025 年间约为 24.49%,根据公开数据,2023 年上半年智慧城市领域总中标金额约为 830 亿元,而 2022 年同期中标金额为 780 亿元,同比上升 6.41%。

工业互联及数字基建应用领域主要客户(如记忆信息、兰盾科技、宁畅信息、 华灏机电等)的下游主要包括工业计算机、云计算、企业级数据中心等领域客户, 该等终端客户从采购到部署安装存在一定周期,其在 2022 年完成了主要建设项 目的物料采购,2023 年 1-6 月主要进行基建部署安装,当期对发行人直接客户的 产品需求出现阶段性下降,相关影响向上传导,使得发行人在工业互联及数字基 建领域收入出现阶段性下降的情况。

4、2023 年上半年发行人各类产品毛利率均出现一定程度变化,主要受上游原厂提价、下游行业、客户结构等因素影响

报告期内,公司主营业务毛利率分别为 9.14%、7.71%、7.78%和 9.78%。2023年 1-6 月,发行人毛利率有所上升,不同类别产品的毛利率较去年同期的变动情况如下:

(番目)	2023	年1-6月	2022年1-6月
项目 	毛利率	变动	毛利率
FPGA及组件	22.94%	+10.67%	12.27%
ASIC	7.01%	-1.54%	8.55%
处理器芯片	4.70%	+1.96%	2.74%

项目	2023	年1-6月	2022年1-6月
	毛利率	变动	毛利率
模拟芯片	8.84%	+0.45%	8.39%
存储芯片	4.18%	-7.76%	11.94%
软件及其他	8.19%	-1.44%	9.63%
合计	9.78%	+1.35%	8.43%

(1) FPGA 及组件

2023年1-6月,FPGA及组件毛利率同比上升了10.67个百分点,主要系受原厂涨价及下游研发项目需求旺盛叠加影响的结果,具体分析如下:

A. 上半年发行人将原厂涨价的预期迅速传导至下游

FPGA 原厂在 2022 年 11 月向市场释放了将上调 FPGA 芯片价格的预期,将在 2023 年上半年对旗下产品上调销售价格。发行人在获悉上游供应商涨价预期后,通过积极备货等方式提前锁定部分产品的成本,并将产品价格上升的预期迅速传导至下游,使得 2023 年上半年发行人 FPGA 的销售单价上升至 181.04 元,较去年同期的 117.83 元提升了 53.64%,即在锁定部分产品成本的情况下实现销售价格提高,使得产品毛利率上升。

B. 上半年下游研发项目需求旺盛,发行人通过提供密集技术支持服务实现 较高毛利

发行人销售的 FPGA 产品可用于下游企业的研发阶段项目和量产阶段项目,用于研发阶段项目的产品毛利率通常高于量产阶段项目的产品毛利率。下游企业研发阶段的项目通常需要发行人提供较为密集的技术支持和服务,并愿意支付较高的价格;项目进入量产阶段后,下游企业需要发行人提供技术支持服务的频率或深度会下降,但采购量通常会上升,出于成本优化方面的考虑,下游企业会与发行人协商更好的价格和条件。

2023 年 1-6 月,发行人 FPGA 产品在数字基建领域、工业互联领域毛利率较高,分别为 26.35%、19.77%,且毛利额占 FPGA 毛利额的比例合计达 91.11%,主要系由于数字基建、工业互联领域中 5G、人工智能、云计算等新兴细分领域的研发创新活动较为活跃,拉升了对发行人 FPGA 芯片及技术服务的需求,使得发行人议价能力增强,叠加上游原厂涨价因素,导致毛利率上升。2023 年 1-6

月,研发项目在 FPGA 产品的收入占比从 2022 年同期 10.50%上升至 40.69%, 使得 2023 年 1-6 月 FPGA 产品毛利率上升。

C. 随着原厂涨价因素消退、下游客户的项目逐步进入量产阶段,发行人下 半年销售 FPGA 产品的毛利率逐渐回归

进入 2023 年下半年,随着原厂涨价因素消退、客户的项目逐步进入量产阶段,发行人在 2023 年下半年销售 FPGA 产品的毛利率逐渐回归,在 2023 年 1-9 月的 FPGA 产品毛利率已回落至 19.84%。

(2) ASIC

2023年1-6月,ASIC毛利率下降了1.54个百分点,主要是因为发行人ASIC产品在大消费、数字基建领域的毛利率较低,分别为4.66%、3.08%,且毛利额占该类产品毛利额的比例合计达30.66%。2023年1-6月,发行人ASIC产品在大消费领域毛利率较低,主要系由于该领域终端需求疲软,毛利率较低;发行人ASIC产品在数字基建领域毛利率较低,主要是因为发行人积极开拓客户,向客户给予一定让利。

(3) 处理器芯片

2023 年 1-6 月,处理器芯片毛利率上升了 1.96 个百分点,主要是因为发行人处理器芯片产品在工业互联、数字基建领域实现了较高的毛利率,分别为 4.53%、5.06%,且毛利额占该类产品毛利额的比例合计达 74.68%。2023 年 1-6 月,发行人处理器芯片产品在工业互联、数字基建领域毛利率较高,主要系由于发行人前期抢占市场的目标已初步达成,原来的让利政策逐步取消,使得毛利率有所提升。

(4) 模拟芯片

2023年1-6月,模拟芯片毛利率上升了0.45个百分点,基本保持稳定。

(5) 存储芯片

2023 年 1-6 月,存储芯片毛利率下降了 7.76 个百分点,主要是因为发行人存储芯片产品在大消费、工业互联领域的毛利率较低,分别为 3.07%、6.46%,且毛利额占该类产品毛利额的比例合计达 75.45%。2023 年 1-6 月,发行人存储

芯片产品在大消费、工业互联领域毛利率较低,主要是因为 2023 年上半年存储行业整体处于较为低迷的行业周期,IDC 数据显示存储行业的市场规模较去年同期整体下降 17%,存储产品价格走低,国际巨头三星电子、海力士出现亏损,国内主要的存储厂商江波龙、佰维存储同期业绩均为亏损。

(6) 软件及其他

2023 年 1-6 月,软件及其他毛利率下降了 1.44 个百分点,主要是因为发行人软件产品在数字基建领域的毛利率仅为 7.59%,且毛利额占该类产品毛利额的比例达 64.94%。2023 年 1-6 月,发行人软件产品在数字基建领域毛利率较低,主要系由于发行人下游客户结构有所调整,大型客户收入占比提升较多,发行人议价空间变小,导致毛利率有所下降。

综上所述,2023年1-6月发行人各类产品毛利率均出现一定程度变化,主要 受上游原厂提价、下游行业、客户结构等因素影响,整体毛利率并未出现下降, 毛利率变化未直接影响发行人业绩规模下降。

5、2023 年上半年发行人实现收入的客户数量减少,存量客户收入存在一定程度下滑、增量客户对收入的贡献同比下降,造成发行人同期收入下滑

(1) 发行人客户数量情况

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
客户数量(家)	2,076	2,125

注:上表已剔除赤狐 CRM 在线软件工具服务。

2023 年上半年,发行人实现主营业务收入的客户数量有所下降,从去年同期的 2,125 家下降到 2,076 家,减少了 49 家。

(2) 发行人存量客户的收入变化情况

2022年1-6月,发行人剔除赤狐 CRM 在线软件工具服务的主营业务收入为408,869.07万元;2023年1-6月保留下来的存量客户主营业务收入为260,347.07万元,金额下降36.33%。具体如下表所示:

2023年1-6月		2022年1-6月
主营业务收入 (万元)	变化率	主营业务收入(万元)
260,347.07	-36.33%	408,869.07

注:上表已剔除赤狐 CRM 在线软件工具服务。

2023年1-6月, 主营业务收入减少金额前五大的客户情况如下表所示:

单位: 万元

项目	2023年1-6月	主营业务收入 减少金额	2022年1-6月
记忆信息有限公司	23.63	24,696.26	24,719.89
华勤通讯香港有限公司	1,709.99	12,277.81	13,987.80
益华行有限公司	3,614.82	11,091.34	14,706.16
正晖科技 (香港) 有限公司	-	5,474.85	5,474.85
宁畅信息产业(北京)有限公司	4.54	4,668.22	4,672.76
合计	5,352.98	58,208.48	63,561.46

注:上表已剔除赤狐 CRM 在线软件工具服务。

1) 记忆信息有限公司

记忆信息有限公司系记忆科技(深圳)有限公司旗下子公司,记忆科技(深圳)有限公司是全球第二大独立内存模组提供商以及全球领先 PC 品牌厂商和信息通讯设备厂,向客户提供内存、固态硬盘 SSD、闪存卡等全系列存储产品及解决方案,产品广泛应用于个人终端、通信设备、工业控制计算机系统、企业级服务器等等。

发行人对记忆信息有限公司的销售额从 2022 年 1-6 月的 24,719.89 万元下降 到 2023 年 1-6 月的 23.63 万元,主要是因为 2023 年上半年下游客户需求疲软,因此当期采购金额下降。

2) 华勤通讯香港有限公司

华勤通讯香港有限公司系上市公司华勤技术股份有限公司(603296.SH)旗下子公司,专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务,主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司等,如三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、LG、宏碁、华硕、索尼等。产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴等智能硬件产品,是一家在全球消费电子 ODM 领域拥有领先市场份额和独特产业链地位的大型科技研发制造企业。

发行人对华勤通讯香港有限公司的销售额从 2022 年 1-6 月的 13,987.80 万元下降到 2023 年 1-6 月的 1,709.99 万元,主要原因系 2023 年 1-6 月其通讯基站项目的以太网连接和端口部署需求下降,从发行人采购的金额下降。

3) 益华行有限公司

益华行有限公司于 1995 年 7 月在香港成立,是行业内领先的 CPU 分销商之一,公司专注于分销处理器、服务器产品、内存模块、SSD、芯片组等产品,其与 Intel、AMD 等国际芯片巨头均建立了业务往来关系。

发行人对益华行有限公司的销售额从 2022 年 1-6 月的 14,706.16 万元下降到 2023 年 1-6 月的 3,614.82 万元,主要原因系该客户主要采购应用于工业电脑等领域的产品,而 2023 年该领域下游需求有所下降,导致发行人对其销售金额有所下降。

4) 正晖科技(香港)有限公司

正晖科技(香港)有限公司成立于 2020 年 9 月 15 日,是一家电子元器件贸易和系统集成公司,主营业务包括软件、电子元器件及电子产品的生产、开发、销售、代理、咨询等。

发行人对正晖科技(香港)有限公司的销售额从 2022 年 1-6 月的 5,474.85 万元下降到 2023 年 1-6 月的 0 万元,下降了 5,474.85 万元,主要原因系正晖科技终端客户的光通讯基站部署具有周期性采购特征,终端客户在上期已完成主要物料采购,当期主要进行基建部署安装,致使正晖科技的采购金额有所下降。

5) 宁畅信息产业(北京)有限公司

宁畅信息产业(北京)有限公司成立于 2019 年 12 月 25 日,是集研发、生产、部署、运维一体的服务器厂商,提供基于 X86 架构通用机架、人工智能、多节点、边缘计算及 JDM 定制等多类型服务器及 IT 基础设施产品。

发行人对宁畅信息产业(北京)有限公司的销售额从2022年1-6月的4,672.76万元下降到2023年1-6月的4.54万元,下降了4,668.22万元,主要原因系客户终端产品用于基建集采项目,具有周期性,采购周期结束后采购金额有所下降。

(3) 发行人增量客户的收入变化情况

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
增量客户数 (家)1	501	609
增量客户收入 (万元)	34,647.75	54,321.13

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
主营业务收入 (万元)	350,653.33	408,869.07
占比	9.88%	13.29%

注1: 2023年1-6月的增量客户为2019-2022年均无主营业务收入,但在2023年1-6月存在交易的客户; 2022年1-6月的增量客户为2019-2021年均无主营业务收入,但在2022年1-6月存在交易的客户;

注2: 上表已剔除赤狐CRM在线软件工具服务。

由上表可知,2022年1-6月发行人增量客户数为609家,2023年1-6月为501家,同比减少17.73%;2022年1-6月发行人增量客户收入为54,321.13万元,2023年1-6月为34,647.75万元,同比减少36.22%;2022年1-6月,发行人增量客户占主营业务收入的比例为13.29%,2023年1-6月为9.88%,同比减少3.41个百分点。从增量客户来看,2023年1-6月发行人增量客户数量及增量客户贡献的收入金额均在减少,增量客户收入在主营业务收入中的占比也有所降低,增量客户对收入的贡献下降。

如上所述,2023年1-6月,发行人客户数量减少、存量客户收入存在一定程度下滑、增量客户对收入的贡献下降,造成发行人2023年1-6月收入下滑。

综合上述芯片分销行业景气度及竞争状况、产品终端应用领域需求具体变化、发行人毛利率、客户变动以及变动原因等情况,2023 年上半年业绩存在下滑的主要原因为: (1)2023 年上半年,半导体行业仍处于去库存的低迷周期,下游市场需求疲软,造成发行人同期收入下滑; (2)2023 年上半年,发行人在工业互联及数字基建领域的收入分别下降了65,582.00 万元、12,342.15 万元,造成发行人同期收入下滑; (3)2023 年上半年,发行人客户数量减少、存量客户收入存在一定程度下滑、增量客户对收入的贡献下降,造成发行人同期收入下滑。

(二) 与行业整体趋势、同行业可比公司对比情况

发行人和同行业可比公司 2023 年上半年经营情况与 2022 年同期相比的变动情况如下表所示:

单位: %

							, ,	
	同行业公司半年度业绩情况(同比变化率)							
项目	深圳华强	商络电子	润欣科技	雅创电子	好上好	中电港	可比公 司均值	发行人
营业收入	-34.45	-8.38	-6.59	-2.18	-23.51	-37.45	-18.76	-14.24
净利润	-48.91	-73.66	-38.36	-60.34	-79.30	-57.03	-59.60	-28.46

由上表可知,发行人及其同行业可比公司经营业绩均呈现不同程度的下滑, 且发行人的业绩下滑低于同行业可比公司均值。根据同行业公开披露信息,其业 绩下滑的原因如下:

1、深圳华强

2023年1-6月,深圳华强的营业收入较上年同期下降34.45%,主要原因系:①受全球经济增速持续放缓、居民消费意愿低等因素影响,消费电子市场持续低迷,电子元器件总体需求较为疲软;②2021年电子元器件行业经历大规模缺货潮后上游扩产较多,2022年缺货潮缓解后行业库存水平较高,自2022年下半年进入去库存周期,2023年上半年仍处于去库存阶段。

2023年1-6月,深圳华强的净利润较上年同期下降48.91%,主要系收入下降、计提存货跌价准备造成的资产减值损失导致。

2、商络电子

2023年1-6月,商络电子的营业收入较上年同期下降8.38%。主要原因系下游几大终端需求的支撑依然较弱,消费电子行业仍未见复苏趋势,工业需求也整体较为平淡。

2023年1-6月,商络电子的净利润较上年同期下降73.66%,主要原因系: (1)持续铺开主动元器件市场、争取新兴领域客户资源,扩招资深行业人员,管理费用、销售费用增长幅度较大; (2)持续聚焦数字化中心的业务开发、强化供应链系统研发,导致研发费用增长幅度较大; (3)低迷的市场环境下,下游需求不足,行业处于持续去库阶段,商络电子计提较大金额存货跌价准备造成资产减值损失。

3、润欣科技

2023年1-6月,润欣科技的营业收入较上年同期下降6.59%,音频及功率放大器件收入下降比例最高,下降了28.72%。主要原因系受全球消费电子市场低迷和电子制造业去库存的影响,智能手机、PC等终端设备的需求下滑。

2023年1-6月,润欣科技的净利润较上年同期下降38.36%,主要原因系: (1) 润欣科技新增微能量收集及超低功耗无线芯片、智能音箱芯片等产品线布局,

积极开拓新客户资源,导致销售费用、管理费用小幅上升; (2)低迷的市场环境下,下游需求不足,行业处于持续去库阶段,润欣科技计提较大金额存货跌价准备造成资产减值损失。(3)除数字通讯芯片及系统及应用产品外,各个产品线毛利率均出现下滑,综合毛利率由11.11%下降为10.24%。

4、雅创电子

2023 年 1-6 月,雅创电子的营业收入较上年同期下降 2.18%,主要系 2023 年一季度汽车终端市场相对疲软,分销业务销售额下滑所致。

2023年1-6月,雅创电子的净利润较上年同期下降60.34%,主要原因系: (1) 相比上年同期,雅创电子合并报表并入欧创芯,员工人数扩充、无形资产摊销金额增加,导致管理费用、销售费用、研发费用增长幅度较大; (2) 2023年上半年行业周期下行,为争取更多市场份额,雅创电子采取主动让利、短期报价调整的策略,分销业务毛利率下降3.59个百分点、自研IC业务毛利率下降7.9个百分点。

5、好上好

2023年1-6月,好上好的营业收入较上年同期下降23.51%,主要系2023年上半年国内外消费电子市场持续疲软,下游客户需求不及预期所致。

2023年1-6月,好上好的净利润较上年同期下降79.30%,主要原因系: (1) 2023年上半年营收下降、毛利减少,同时对销售市场的资源投入和职工薪酬较上年同期增加,导致销售费用上升; (2) 低迷的消费电子市场环境下,下游需求不足,行业处于持续去库存阶段,公司计提较大金额存货跌价准备造成资产减值损失。

6、中电港

2023 年 1-6 月,中电港的营业收入较上年同期下降 37.45%,主要系行业周期持续下行,下游应用领域的终端需求缩减所致。

2023年1-6月,中电港的净利润较上年同期下降57.03%,主要原因系受宏观经济增速放缓、市场需求低迷影响,中电港收入总体下降,同时公司利息支出增加,进一步导致净利润下滑。

综上,由于半导体行业仍处于低景气周期,下游市场需求回升疲软,发行人 所处的芯片分销行业整体均受此影响。因此,2023年1-6月业绩有所下滑,但变 化趋势与同行业可比公司基本相同,并无按照显著差异。

(三) 未来经营业绩是否存在进一步下滑风险

1、半导体市场短期已连续数月维持回暖趋势,长期具有较高成长性

截至2023年上半年,全球半导体市场销售额仍低于去年同期,但6月份单月全球销售额收录415亿美元,同比增长1.70%,并且连续4个月实现环比增长,季度环比增长稳健,2023年下半年市场有望持续复苏。

长期来看,全球半导体产业的发展空间广阔。根据 IC Insights 数据,2022年全球半导体市场规模为6,810亿美元,预计2025年全球半导体市场将达到7,870亿美元,2022-2025年复合增长率为4.94%。



单位: 十亿美元

数据来源: IC Insights

受益于通讯技术、电子信息技术等领域的更新迭代,同时在人工智能、云计算、物联网、智能汽车、工业互联网等新兴领域的驱动下,2020 年以来全球芯片市场的收入实现增长。根据 WSTS 的数据,2022 年全球芯片市场销售规模为5,340.1 亿美元,预计 2024 年全球芯片市场销售规模将达到 6,020 亿美元,2022-2024 年年复合增长率为 6.18%。

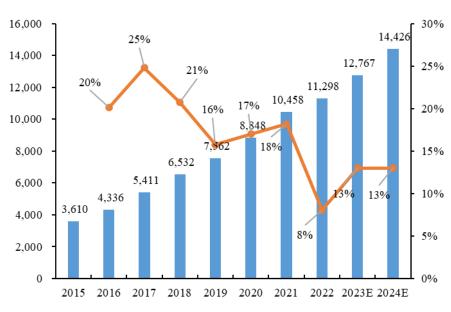
单位: 亿美元



数据来源: WSTS

得益于我国科技的快速发展以及芯片应用领域不断拓展,我国成为了全球最大的芯片消费国之一。根据中国半导体行业协会的数据,2022 年我国芯片市场规模为11,298 亿元,预计2022-2024 年将保持13.00%的年均复合增长率。根据中国半导体行业协会预测,在2024 年我国芯片销售额将达到14,426 亿元。

单位: 亿元



数据来源:中国半导体行业协会

2、发行人下游应用领域具有较高市场需求,未来增长前景良好

发行人下游行业为电子产品制造业,覆盖了在生产经营过程中需要使用到电子产品的企业,终端产品涵盖智能汽车、数字基建、工业互联、能源控制、大消费等细分领域,各终端领域均具有较高的成长性。

工业互联是电子元器件的下游重要应用领域,行业具有较高的成长性。2022年国务院印发《"十四五"数字经济发展规划》要求围绕工业领域,提出纵深推进工业数字化转型,深入实施智能制造工程,大力推动装备数字化。除国家政策大力支持工业互联的发展与应用,5G通信的建设发展进一步加速工业互联的应用。中国电子信息产业发展研究院发布的《2022-2025年中国工业互联网市场研究年度报告》显示,2022年中国工业互联网市场规模总量达到8,648亿元,预计到2025年,中国工业互联网市场规模达到12,688亿元,预测复合增长率为13.8%。

数字基建是数字经济特征的新一代信息基础设施建设,智慧城市市场发展前景较好,相关智能化设备的应用需求不断上升,有助于电子元器件市场的发展。IDC数据显示,受益于相关技术进步持续的迭代升级、我国城镇化率不断提升以及国家相关政策的鼓励,2020年我国智慧城市市场规模达到14.90万亿元,预计2025年我国智慧城市市场规模将达到48.39万亿元,2020-2025年年复合增长率为26.57%。2023年上半年智慧城市领域总中标金额约为830亿元,较去年同期中标金额780亿元增长6.41%。

消费电子是电子元器件应用量较大的领域,行业有望在2023年下半年探底回升。2023年7月20日,国家发改委出台了《关于促进电子产品消费的若干措施》,措施指出要加快推动电子产品升级换代,顺应新一轮科技革命和产业变革趋势,推动供给端技术创新和产业升级,促进电子产品消费升级。政策端的大力支持有望提振消费信心、助力电子产品需求的提升。同时,据业内机构研究,国内智能手机的换机周期约为34个月,在经历过三年的调整期后,国内智能手机市场即将进入更新换代周期。在此背景下,国内各手机大厂纷纷推出新款旗舰手机,有望进一步推动下游需求。综上,在政策端的支持、下游需求的回暖和热点事件的推动下,消费电子行业有望在2023年下半年探底回升。

我国智能汽车市场规模巨大且稳步增长,是电子元器件下游重要应用领域。2023年6月2日起,国务院常务会议、国家发改委、国家商务部等先后提出《研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施》、《关于促进汽车消费的若干措施》、《汽车行业稳增长工作方案(2023—2024年)》,旨在促进我国汽车消费。中国汽车工业协会公布的数据显示,2023年1-6月,我国新能源汽车产、销分别实现378.8万辆和374.7万辆,同比分别增长42.4%、44.1%。数据显示我国人均保有量数据与发达国家还有一定差距,未来随着居民收入的不断提高,消费的不断升级,汽车市场仍有较大增长空间。新能源汽车领域对芯片的需求远高于传统汽车,发行人在智能汽车领域仍有较大的发展空间。

在能源控制领域,随着国家经济的高速发展,智慧能源行业呈现出蓬勃发展趋势。2023年3月28日,国家能源局发布了《国家能源局关于加快推进能源数字化智能化发展的若千意见》,意见指出能源产业与数字技术融合发展是新时代推动我国能源产业基础高级化、产业链现代化的重要引警。同时,该意见提出了切实有效的推进能源数字化智慧化的举措。我国"双碳"目标的提出,未来将使智慧能源产业迎来高速发展。根据预测,2021-2025年,中国智慧能源行业的市场规模将以每年10%-15%的速度稳步增长,2025年市场规模约为4.9万亿元。未来能源控制领域的市场规模增长,也将带来发行人业绩的飞速发展。

3、发行人具有较强的竞争优势、构筑了较高的竞争壁垒,经营业绩进一步 下滑的风险较低

2020年、2021年、2022年及2023年1-6月,公司的营业收入分别为422,149.08万元、762,083.82万元、807,423.63万元及350,691.57万元,2020至2022年复合增长率达38.30%,净利润分别为15,922.81万元、31,281.65万元、30,893.84万元和12,143.87万元,2020至2022年复合增长率达39.29%,发行人历史业绩增长强劲。

发行人在电子元器件分销行业深耕多年,积累了过硬的技术实力和深厚的行业经验,并建立了完善的营销服务体系,综合服务能力得到上游原厂和下游客户的普遍认可,树立了较高的品牌优势。历经多年发展,发行人获得了国内外知名原厂80余条国内外优质授权产品线,已成为境内知名的芯片授权分销商,对芯片应用技术服务、运用场景等具有深刻的理解,并储备了一批高素质人才队伍和专业技术知识。一方面,当上游原厂推出新产品时,公司研发团队能迅速理解产品

技术并加以运用,在原厂芯片既定功能的基础上提出适当的应用方案;另一方面,发行人为客户配备完善的工程师队伍,在客户进行产品开发面临难点时提供针对性解决方案,可以帮助客户显著降低研发成本、缩短研发时间,对客户产品设计开发形成推动性支持,进而深入绑定客户,进一步增加客户粘性。

相较国内其他电子元器件分销商,公司代理的产品线均具备较高的品牌知名 度和可靠的产品质量,发行人自身具备较强的市场开拓能力、产品推广能力、优 质的下游客户和技术服务能力,在芯片分销市场中建立了良好的口碑,积累了优 质的客户资源并建立了完善的销售渠道。

综上所述,发行人未来的成长受到宏观经济形势、行业动态、竞争格局、市场开拓能力、技术实力等多重因素的影响,预期前述因素在可预见的时间范围内不会发生重大不利变化,发行人经营业绩进一步下滑的风险较低。

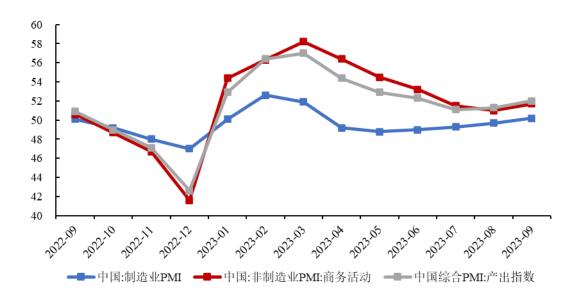
4、根据同行业其他公司判断,及前瞻性经济指标回升的趋势,下半年全国 电子元器件市场景气度有望回升

受外部行业因素影响,发行人与多数同行业上市公司 2023 年上半年业绩均 出现明显下滑,与此同时,根据同行业上市公司相关公告,部分电子元器件分销 商判断 2023 年第二、三季度国内电子元器件市场行情将逐步企稳,下半年景气 度有望回升,具体情况如下表:

序号	公司名称	行业地位	具体内容
1	深圳华强 (000062.SZ)	国内领先的电子 元器件分销商	2023 年下半年,电子元器件行业去库存周期将进入尾声,随着新一轮创新周期持续推进、中国经济进一步复苏等,电子元器件行业的需求预计也将逐步提升,行业有望回暖并迎来新一轮景气周期
2	雅创电子 (301099.SZ)	国内知名的电子 元器件分销商	半导体行业方面,2023年3月起全球及中国区半导体销售额均有所回升。从需求端来看,2023年二季度起公司下游汽车行业形势明显好转
3	商络电子 (300975.SZ)	国内知名的电子 元器件分销商	总体来说,大部分被动元器件的低谷已经过去。此外,下半年将迎来消费电子的传统旺季,在历经下行周期行业出清和去库存后,传统消费电子需求有望反弹,新老需求共振,带动相关元器件等订单回升
4	好上好 (001298.SZ)	国内知名的电子 元器件分销商	公司业绩同比有所下滑,但环比有所增长;2023年第二季度业绩环比第一季度有所好转
5	中电港 (001287.SZ)	国内知名的电子 元器件分销商	从需求侧来看,因国家推进2030碳排放达峰目标而大规模发展清洁能源以及欧洲能源危机影响,新能源汽车、光伏风电及储能客户需求有所增长

此外,电子元器件是电子信息产业的基础,是包括电子设备、汽车、家电、通信设备等制造业产品的基础组成部分。因此,制造业的活动水平往往直接影响电子元器件的需求。例如,当制造业生产活动持续加快时,对于用于生产的电子元器件的需求也将增加,电子元器件分销商的收入也有望上升。

在重要的经济指标中,制造业采购经理指数(PMI)作为高频的经济前瞻性指标,能够较好地衡量制造业的生产活动水平。当 PMI 指数超过 50 时,表示制造业正在扩张,当 PMI 指数低于 50 时,表示制造业正在收缩。2022 年 9 月-2023 年 9 月,中国制造业采购经理指数(PMI)、非制造业商务活动指数和综合 PMI产出指数情况如下:



根据上图所示,中国制造业采购经理指数(PMI)、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数当前整体处于逐渐回升的阶段。特别是2023年8月以来,中国制造业采购经理指数(PMI)、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均呈现上升趋势,且在2023年9月均超过了50,表明制造业处于扩张,反映出我国制造生产活动的回暖趋势,受下游需求恢复的影响,我国电子元器件市场行情将有望逐步企稳,下半年景气度出现回升。

5、发行人 2023 年全年经营业绩预计情况

发行人管理层根据经营环境、市场行情、库存情况、在手订单及市场开拓情况估算,对2023年全年经营业绩预计如下:

单位:万元

项目	项目 2023 年度 (预计)		变动情况
营业收入	780,966.34~803,463.31	807,423.63	-3.28%~-0.49%
归属于母公司股东的净利润	24,626.14~25,301.08	30,826.66	-20.11%~-17.92%
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	23,691.39~24,366.30	30,755.26	-22.97%~-20.77%

- 注:上述 2023 年全年财务数据为公司估算数据,未经会计师审计或审阅,且不构成盈利预测或业绩承诺。
- 二、说明 2022 年末、2023 年上半年末存货构成、包含预估返利的存货金额及占比情况、库龄、期后结转情况、2023 年上半年末订单覆盖率;在 2022 年营业收入增速放缓、2023 年上半年营业收入存在下滑情况下,2022 年末、2023 年上半年末存货余额持续大幅增长的原因,发行人存货是否存在大额滞销、退换货的情形;结合 2022 年末、2023 年上半年末存货减值测试方式与具体过程等进一步说明发行人计提存货跌价准备的充分性
- (一) 2022 年末、2023 年上半年末存货构成、包含预估返利的存货金额及 占比情况、库龄、期后结转情况、2023 年上半年末订单覆盖率

1、2022年末、2023年上半年末存货构成

2022 年末及 2023 年上半年末存货构成情况如下:

单位: 万元

产品类别	2023年6	月 30 日	2022年12月31日	
一面失为	金额	占比	金额	占比
FPGA(可编程逻辑芯片)及组件	418,784.89	82.66%	311,293.57	76.30%
ASIC (应用型专用芯片)	17,109.85	3.38%	17,928.06	4.39%
处理器芯片	31,122.05	6.14%	28,051.25	6.88%
模拟芯片	21,697.89	4.28%	27,829.75	6.82%
存储芯片	7,169.68	1.42%	12,059.41	2.96%
软件及其他	10,774.44	2.13%	10,802.17	2.65%
总计	506,658.80	100.00%	407,964.21	100.00%

2022年末及2023年上半年末公司存货账面余额以FPGA(可编程逻辑芯片) 及组件为主,结存金额占比分别为76.30%和82.66%,结存金额占比较高。主要 原因系: (1) FPGA 芯片具备半定制化、可编程化等特点,广泛应用于科技创 新领域,近年来应用需求及市场规模不断增长; (2)赛灵思公司产品市场竞争 力较强,发行人于 2010 年取得赛灵思分销授权,与其合作情况稳定且良好;(3) Xilinx(赛灵思)产品呈现高定价、高返利特征,公司按照含返利的目录采购价格进行采购。

2022年末及2023年上半年末存货剔除预估返利金额后按类别构成情况如下:

单位: 万元

产品类别	2023年6	月 30 日	2022年12月31日		
)如矢加	金额	占比	金额	占比	
FPGA (可编程逻辑芯片) 及组件	44,103.21	42.73%	34,502.37	32.93%	
ASIC (应用型专用芯片)	12,245.48	11.86%	13,545.73	12.93%	
处理器芯片	20,690.69	20.04%	20,695.67	19.75%	
模拟芯片	16,465.05	15.95%	23,050.71	22.00%	
存储芯片	3,053.63	2.96%	6,873.11	6.56%	
软件及其他	6,667.09	6.46%	6,099.01	5.82%	
总计	103,225.16	100.00%	104,766.60	100.00%	

扣除预估返利后,发行人 2023 年上半年存货较 2022 年末并未上升,存货结构中,FPGA(可编程逻辑芯片)及组件仍然在发行人存货中占重要比例,但其占比较扣除预估返利前大幅下降。

2、2022年末、2023年上半年末包含预估返利的存货金额及占比情况

2022年末及2023年上半年末包含预估返利的存货金额及占比情况如下表所示:

单位: 万元

项目	2023年6	月 30 日	2022年12月31日		
	金额	占比	金额	占比	
包含预估返利存货	481,926.46	95.12%	370,757.93	90.88%	
不包含预估返利存货	24,732.33	4.88%	37,206.29	9.12%	
总计	506,658.80	100.00%	407,964.21	100.00%	

2022 年末及 2023 年上半年末,公司包含预估返利的存货账面余额占比分别为 90.88%和 95.12%,包含预估返利的存货主要以 Xilinx (赛灵思)的 FPGA (可编程逻辑芯片)及组件为主,占预估返利的存货的比例为 86.64%、83.48%。

公司2022年末及2023年上半年末剔除预估返利后的存货结构占比情况如下:

单位:万元

项目	2023年6	月 30 日	2022年12月31日		
	金额	占比	金额	占比	
包含预估返利存货剔除预估返利后	78,492.83	76.04%	67,560.32	64.49%	
不包含预估返利存货	24,732.33	23.96%	37,206.28	35.51%	
总计	103,225.16	100.00%	104,766.60	100.00%	

剔除预估返利后,2022 年底公司主要存货(前五大产品线)是 Xilinx、Skyworks、Intel、Mellanox、Microchip等产品,合计占剔除返利后存货比为60.65%。2023年6月末公司主要存货(前五大产品线)是 Xilinx、Microchip、ST、Intel、Skyworks等产品,合计占剔除返利后存货比分别为70.51%。

3、2022年末、2023年上半年末包含预估返利的存货库龄情况

2022 年末及 2023 年上半年末公司存货库龄情况如下:

单位:万元

项目	2023年6	月 30 日	2022年12月31日		
火 日	金额	占比	金额	占比	
1年以内	491,112.95	96.93%	406,097.75	99.55%	
1-2 年	14,570.93	2.88%	1,153.37	0.28%	
2年以上	974.91	0.19%	713.10	0.17%	
总计	506,658.80	100.00%	407,964.21	100.00%	

由上表可知,2022年末及2023年上半年末公司存货库龄均以一年以内存货为主,占比分别为99.55%及96.93%。其中2022年末及2023年上半年末公司包含预估返利的存货库龄具体情况如下:

单位:万元

项目	2023年6	月 30 日	2022年12月31日		
火 口	金额	占比	金额	占比	
1年以内	470,584.55	92.88%	370,375.87	90.79%	
1-2 年	11,184.78	2.21%	343.38	0.08%	
2年以上	157.14	0.03%	38.67	0.01%	
总计	481,926.46	95.12%	370,757.93	90.88%	

由上表可知,2022年末及2023年上半年末公司包含预估返利的存货库龄在一年以内的占比分别为90.79%和92.88%,一年以上的占比分别为0.09%和2.24%,

上述存货库龄以1年以内为主,库龄普遍较短,不存在存货滞销的情况。

4、说明 2022 年末、2023 年上半年末包含预估返利的存货期后结转情况

2022 年末及 2023 年上半年末,包含预估返利的存货的截至 2023 年 12 月末的期后结转情况如下:

单位:万元

类别	项目	2023年6月30日	2022年12月31日
	存货余额	506,658.80	407,964.21
存货整体	期后结转比例	42.30%	79.92%
情况	剔除返利后的余额	103,225.16	104,766.60
	剔除返利后的期后结转比例	50.99%	79.71%
	存货余额	481,926.46	370,757.93
包含预估	期后结转比例	40.92%	78.99%
返利存货	剔除返利后的余额	78,492.82	67,560.32
	剔除返利后的期后结转比例	45.54%	77.29%

注: 上述期后结转主要包括向客户销售和向供应商退货等方式

截止到 2023 年 12 月末,2022 年末存货期后结转情况较好,存货整体期后结转比例为 79.92%,其中包含预估返利部分的存货期后结转比例为 78.99%,公司 2022 年末存货期后结转情况较好。若剔除返利后,2022 年末公司整体存货及包含预估返利存货的期后结转比例分别为 79.71%及 77.29%。

截止到 2023 年 12 月末,公司 2023 年 6 月末公司整体存货及包含预估返利存货的期后结转比例分别为 42.30%及 40.92%,期后结转比例较低,主要原因系 2023 年 6 月末存货,发行人根据客户订单对产品进行备货采购,客户暂未完成提货。若剔除返利后,2023 年 6 月末公司整体存货及包含预估返利存货的期后结转比例分别为 50.99%及 45.54%。

2023年6月末发行人备货情况及后续的结转情况如下表所示:

单位: 万元

序列	供应商	截至2023年6 月30日库存金 额	截至2023年6 月30日剔除 返利后的金 额	2023年6月30 日有效订单金 额	涉 び 単 学 量	上述客户2022 年销售额	截至2023年11 月30日剩余库 存金额	截至2023年 11月30日剩 余库存剔除 返利后的金 额
1	第 大 存 供 应	417,521.62	43,375.08	213,568.60	381	129,296.75	308,322.40	33,301.18
2	第二 大	20,702.59	11,444.14	61,215.59	223	17,471.80	12,903.15	7,323.62
3	第三 库 供 应商	14,654.26	8,852.24	29,743.03	147	7,370.38	9,859.08	6,158.75
4	第四 大 存 应 应	7,088.58	3,829.83	54,383.35	12	1,128.41	5,207.64	2,527.08
5	第五 库供 应	6,901.35	4,224.80	39,160.89	97	54,319.19	3,684.20	2,278.08
<u></u>	ों	466,868.40	71,726.09	398,071.47	-	209,586.52	339,976.47	51,588.70

截至 2023 年 6 月 30 日,发行人存货前五大供应商的存货余额为 466,868.40 万元,存货总余额为 506,658.80 万元,占比为 92.15%,因此,前五大供应商存货的期后结转情况可以反映发行人存货的整体结转情况。

截至 2023 年 6 月 30 日,发行人库存前五大供应商剔除返利后的存货余额为 71,726.09 万元,对应的有效订单金额为 398,071.47 万元。由于发行人大部分有效订单为普通订单,客户可能出现推迟提货、延迟履行普通订单的情况,因此发行人根据自身销售计划和库存情况,结合市场环境及客户履约进度,按照有效订单金额的一定比例进行备货采购。

发行人与上述有效订单的客户有持续合作的历史,且客户未来有持续交易的意向,上述有效订单的客户 2022 年销售额为 209,586.52 万元,大于 2023 年 6 月末剔除返利后的存货余额。

由于客户自身项目延迟、更新项目方案、需求节奏调整等原因,客户可能出现延迟提货、延迟履行普通订单的情形,但发行人的商业模式决定其不存在大额滞销或退换货的风险,具体分析参见本题"(二)、2、(2)发行人的商业模式决定其不存在大额滞销或退换货的情形"。

5、2023年上半年末订单覆盖率

公司的订单类型主要分为带不可取消条款的有效订单、未带不可取消条款的有效订单、意向订单三种类别,具体如下:

订单种类	定义	是否进入公司系统	是否可取消、可变更
带不可取消条款的 有效订单(以下称" 不可取消订单")	具有法律效力的正式订单,附带"不可取消,不可更改交期"条款,即下单后不可以根据双方需求协商变更和取消	是	否
未带不可取消条款 的有效订单(以下称 "普通订单")	具有法律效力的正 式订单,未明确不可 取消	是	基于行业惯例可以根据双方需求协商变更和取消
意向订单	根据行业惯例,客户 会根据自身生产计划,提前将产品需求 告知分销商,该等产品需求和计划不具有约束力,仅供各方作商业预测参考	否	是

在公司的有效订单中,带不可取消条款的有效订单("不可取消订单")双方均无法取消、无法变更,因此,基于谨慎性的原则和行业惯例,公司仅使用不可取消订单做为存货跌价计提测算的依据。而未带不可取消条款的有效订单("普通订单")基于行业惯例可以进行变更,因此没有作为发行人存货跌价准备测算的依据。意向订单则不具有约束力,仅供各方作商业预测参考。

基于上述,2023年上半年末公司存货在2023年6月末的不可取消订单覆盖率为8.84%,有效订单(不可取消订单加普通订单)覆盖率为80.28%。公司的产品下游订单覆盖情况良好,2023年上半年行业仍处于低景气周期,但未来随着下游市场需求回暖,公司将逐步消化现有订单,增加出货规模。

- (二)在 2022年营业收入增速放缓、2023年上半年营业收入存在下滑情况下,2022年末、2023年上半年末存货余额持续大幅增长的原因,发行人存货是否存在大额滞销、退换货的情形
 - 1、2022年末、2023年上半年末存货余额持续大幅增长的原因
- (1) 发行人存货账面余额增长主要原因是第一大库存供应商产品账面余额增长较多,其中 2022 年末其他产品的存货账面余额也有所增长

2022 年末、2023 年上半年末,公司存货账面余额持续增长,相关情况如下表所示:

单位: 万元

日期	项目	账面纸	è 额	扣除预估返利后余额		
口州		金额	占比	金额	占比	
	第一大库存 供应商产品	417,521.62	82.41%	43,375.08	42.02%	
2023/6/30	其他产品	89,137.18	17.59%	59,850.08	57.98%	
	合计	506,658.80	100.00%	103,225.16	100.00%	
	第一大库存 供应商产品	309,496.08	75.86%	32,389.36	30.92%	
2022/12/31	其他产品	98,468.13	24.14%	72,377.24	69.08%	
	合计	407,964.21	100.00%	104,766.60	100.00%	
2021/12/31	第一大库存 供应商产品	163,862.12	74.12%	5,995.95	11.96%	
	其他产品	57,204.54	25.88%	44,148.34	88.04%	
	合计	221,066.65	100.00%	50,144.29	100.00%	

2022 年末,发行人存货账面余额相比 2021 年末增长 186,897.56 万元,其中第一大库存供应商产品增长 145,633.97 万元,其他产品增长 41,263.59 万元;扣除预估返利后的存货余额增长 54,622.31 万元,其中第一大库存供应商产品增长 26,393.41 万元,其他产品增长 28,228.90 万元。2022 年末发行人第一大库存供应商产品和其他产品的存货均呈现增长,主要原因为,一方面公司加大了部分产品的备货,另一方面,部分客户因其下游客户需求阶段性满足,采购周期推迟,延迟了向发行人提货的时间。由于第一大库存供应商产品的高定价、高返利特征,含返利的存货账面余额中第一大库存供应商产品的账面余额增长较多。

2023 年 6 月末,发行人存货账面余额相比 2022 年末增长 98,694.59 万元,其中第一大库存供应商产品增长 108,025.54 万元,其他产品下降 9,330.95 万元;扣除预估返利后的存货余额下降 1,541.44 万元,其中第一大库存供应商产品增长 10,985.72 万元,其他产品下降 12,527.16 万元。2023 年 6 月末公司存货账面余额增加主要是由于第一大库存供应商产品的存货增加,其他产品的存货相比 2022 年末下降,其他产品的存货变动趋势与发行人收入的下降趋势基本一致。

(2)下游创新创意领域需求增加及发行人适当备货,促使发行人第一大库 存供应商产品的存货增长,其中高返利特征的存货增长较多,导致存货账面余

额增长较多,发行人出现阶段性高库存

虽然发行人在手有效订单金额较高,但大部分为普通订单,电子元器件分销 行业的市场价格通常随行就市,在产品市场价格下跌,或者公司的下游客户自身 生产计划发生改变的情况下,部分客户可能出现推迟提货、延迟履行普通订单的 情况,这将导致发行人的库存出现阶段性的上升。

2022 年末,第一大库存供应商产品的存货账面余额增长 145,633.97 万元, 而扣除返利后的实际余额仅增长 26,393.41 万元; 2023 年 6 月末,第一大库存供 应商产品的存货账面余额增长 108,025.54 万元,而扣除返利后的实际余额仅增 长 10,985.72 万元。第一大库存供应商产品存货账面余额增长的主要原因是账面 余额中返利金额增长较多,具体体现为高倍数返利型号的存货在库存中占比增加, 具体如下:

单位:万元

第一大库存供应商 2023年 产品存货		5月30日	2022年12月31日		2021年12月31 日
返利占采购比	金额	变化额	金额	变化额	金额
≥70%	409,593.05	109,899.12	299,693.93	138,911.79	160,782.14
60%-70%	4,451.04	-177.18	4,628.22	3,782.46	845.76
50%-60%	1,257.53	-640.45	1,897.98	1,681.91	216.07
<50%	2,219.99	-1,055.96	3,275.95	1,257.81	2,018.14
合计	417,521.62	108,025.54	309,496.08	145,633.97	163,862.12

2022 年 12 月 31 日,第一大库存供应商产品中,返利高于 70%的存货金额为 299,693.93 万元,较 2021 年 12 月 31 日增加了 138,911.79 万元,主要原因是:一方面第一大库存供应商的 FPGA 产品有着较强的并行计算能力和灵活的编程能力,随着 2022 年工业互联、数字基建领域中 AIGC 等引发的技术革新,激发了终端客户和应用的研发需求,发行人对部分产品进行适当备货;另一方面,数字基建等领域客户完成了主要建设项目的物料采购后,延迟了提货的时间,进一步导致发行人期末存货上升。上述领域的第一大库存供应商产品呈现高返利的特征,进而导致存货账面余额增长较多。

2023 年 6 月 30 日,返利高于 70%的存货金额为 409,593.05 万元,较 2022 年 12 月 31 日增加了 109,899.12 万元,主要原因是数字基建领域中 5G、人工智能、云计算等新兴细分领域的研发创新活动较为活跃,发行人根据客户订单对特

定产品进行备货采购,客户暂未完成提货,而上述领域的第一大库存供应商产品 呈现高返利的特征,进而导致存货账面余额增长较多。

上述应用领域的第一大库存供应商产品呈现高返利的特征,为上游原厂根据 当期推广策略综合决定,发行人无法对返利比例进行干预。

2、发行人存货是否存在大额滞销、退换货的情形

(1)发行人剔除返利后的存货周转率均高于同行业可比公司平均水平,具 有其合理性

电子元器件分销行业的市场价格通常随行就市,在产品市场价格下跌,或者公司的下游客户自身生产计划发生改变的情况下,部分客户可能出现推迟提货、延迟履行订单的情况,这将导致发行人的库存出现阶段性的上升,但并不意味着发行人存在大额滞销存货。虽然 2023 年发行人的库存水平较 2020-2022 年度阶段性升高,主要是由于该等年度的市场需求过于旺盛,发行人产品供不应求,因此该等年度库存水平较低,而今年的库存虽然有所上升,但仍然处于合理水平。

报告期内,公司整体存货周转率及扣除预估返利后的存货周转率与同行业对比具体情况如下:

单位:次

公司简称	2023年1-6月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
深圳华强	5.08	6.95	8.58	8.68
商络电子	4.62	5.89	8.43	8.02
润欣科技	3.93	5.30	8.37	10.15
雅创电子	3.78	5.94	9.10	10.14
好上好	8.96	8.70	10.63	13.59
中电港	3.05	4.05	5.51	10.02
可比公司均值	4.90	6.14	8.44	10.10
可比公司范围	3.05~8.96	4.05~8.70	5.51~10.63	8.02~13.59
发行人 (整体存货周转率)	1.38	2.37	5.47	12.11
发行人(扣除预估返利后存 货周转率)	6.08	9.61	21.83	29.92

报告期内,公司整体存货周转率分别为 12.11 次、5.47 次、2.37 次和 1.38 次, 2021 年、2022 年及 2023 年 1-6 月存货周转率下降,主要原因是公司存货规模不断提升,其中,Xilinx(赛灵思)、Mellanox(迈络思)、Microchip(微芯)等

产品线的存货期末余额均有一定幅度的上升。该等产品线主要采用 POS 模式,公司以名义价格采购、并向下游形成销售后,将获得供应商抵扣货款的凭证,因此存货账面金额较大。

公司扣除返利后的存货金额更能反映公司的真实运营状况,报告期内,公司扣除预估返利后的存货周转率分别为 29.92 次、21.83 次、9.61 次和 6.08 次,公司存货周转情况良好,周转率均高于同行业可比公司均值。

(2) 发行人的商业模式决定其不存在大额滞销或退换货的情形

发行人主要采用 POS 模式进行采购销售,报告期内该模式对应的采购占比超过 96%。POS 模式是欧美芯片原厂普遍采用的销售模式,发行人以目录价格向原厂采购,在实现销售后,原厂以实际采购价与公司进行结算,目录价格和实际采购价格的差异作为原厂给予发行人的返利。在此种商业模式下,当发行人阶段性库存升高时,主要通过如下三种手段消纳库存:

①公司实时跟踪有效订单客户的需求,推动客户履行订单

公司有效订单充裕,公司可以跟踪客户需求,积极推动订单的执行。客户未能如期提货的解决措施主要包括以下三种场景:

未如期提货 的场景	场景描述	解决措施
场景一	客户下单时价格较高,但后续市 场价格下跌,导致在手订单价格 高于市场价格	公司与客户进行充分沟通,了解其仍有产品需求,但因为价格原因延迟提货,公司向原厂申请价格调整,促进销售
场景二	客户因其下游需求调整,导致其 提货意愿下降	公司主动跟进市场机会并持续跟进客户需 求,在市场需求回暖时促使客户提货
场景三	客户产品迭代、更新应用方案, 客户未按原计划提货	公司让客户充分了解新产品技术要点及核 心参数,并积极协助客户进行新产品研发, 促进销售

场景一,如果因在手订单价格过高导致客户提货意愿下降,发行人会及时向原厂反馈市场价格,并且申请价格调整,促进客户履行在手订单。例如,客户A在 2023年2个24日下了关于******0-1SBG****的275,970.24美金订单,该订单单价为84.24美金,但因下游市场变化价格下降,发行人于2023年8月11日向原厂申请价格调整,原厂批准下调实际采购价,发行人因此将单价降低为78美金,促进了客户的提货。

场景二,如果下游需求阶段性放缓导致客户提货意愿下降,公司将持续跟踪

客户需求,并在需求回暖时及时推动客户履行在手订单。例如,客户 B 在 2023 年 6 月 4 日下了关于******5-1FFG****的 43,800 美金订单,原定交货期限为 2023 年 6 月 30 日,因客户下游需求放缓,推迟了提货周期,发行人主动了解客户生产计划,结合行业相同应用的需求回升迹象、以及客户自身必要试产周期等因素,说服客户启动提货和生产避免丧失市场先机,客户于 2023 年 8 月 21 日向发行人提货。

场景三,如果下游客户产品迭代,更新了芯片应用方案,导致库存产品未能按照原计划提货。发行人会派出应用工程师现场拜访客户研发团队,了解新产品技术要点和核心参数,协助推进新产品研发,实现库存销售。例如,客户C在2022年4月22日向发行人订购******5-2FLVA1517I****合计450片,交期原计划为2023年4月15日,由于客户超声检测产品迭代需求,发行人根据芯片自身性能,重新设计电路板布局、绘制原理图,经过参数调试和线上验证,实现128通道封装产品的图像显示功能,形成了新的芯片应用方案。经过次沟通和现场调试,推动客户的试产进度,在12月末促进客户追加订单并提货1,100片用于量产。

②产品线经理主导寻找新的市场机会,帮助公司消化库存

发行人产品线经理的一项核心工作是为代理产品不断寻找新的市场机会。

当发行人由于某一客户的需求变动导致销售延迟形成长期库存时,产品线经理根据产品特性和新市场应用反馈,寻找新的应用场景和市场领域,将产品型号导入新的应用方案,实现库存消耗。例如,2022年2月11日,客户D向发行人订购微处理器产品****253-IR4X,交期2023年4月。由于终端需求低于预期,客户提货速度放缓。发行人业务端了解到客户E所生产的工业服务器产品正在使用同系列的****252I/PT,库存产品是该型号的升级产品,升级产品增加了引脚个数提高链接效率。发行人产品线经理联络到负责该客户的销售人员,实地拜访客户,协助更新设计方案,最终说服客户升级产品至****253-IR4X,目前已进入试产送样阶段。

③公司产品的平均生命周期较长,出现完全无法销售的存货可能性较低。对于无法销售的存货或客户退货,公司可按照代理协议向原厂申请退货

发行人代理的产品主要应用于工业领域,消费领域占比较低。发行人主要产

品的生命周期较长,因此出现完全无法销售的存货可能性较低。通常而言,FPGA及组件产品的平均产品生命周期为 5-7 年,部分型号生命周期甚至达到 20 年,至今还在销售和使用。ASIC 芯片平均生命周期 3-4 年;处理器芯片中,中央处理器平均生命周期 1-2 年,微控制器 2-3 年;模拟芯片生命周期一般 5 年以上;存储芯片平均生命周期 1-2 年;软件产品为芯片应用研发工具,生命周期 3-5 年。

公司产品生产周期较长,可以在较长时间段内持续销售,如果通过上述措施确实都无法销售,并且产品库龄较长,公司通常向供应商申请退货。根据公司和主要供应商的代理协议,其允许一定比例的退货金额,例如,A公司规定公司可以按照每季度目录采购金额的 3.5%作为退货额度,B公司规定公司可以按照每季度目录采购金额的 5%作为退货额度,因此无法销售的存货或客户退货,公司将同原厂进行协商退货。

例如,发行人的 B 公司的******04A-SS****的产品在库周期较长,发行人于 2023 年 10 月 20 日向原厂申请了退货,原厂于 2023 年 10 月 24 日审批通过该等退货需求,同意发行人退还该部分存货 180,600 美金。

除了常规退货,为了加速消耗库存,发行人会针对特定领域的库存向供应商申请特别退货。供应商通常为了提高该领域的市场占有率、充分实现自身产品在多场景的实际应用,同意特别退货申请。例如,2023年11月23日,发行人业务人员结合客户产品未来迭代趋势和供应商新产品技术兼容性,向A公司提出合计货值1.18亿元的特别退货申请,经过供应商渠道和运营人员评估,12月13日供应商同意特别退货申请。发行人已于12月13日当日将产品退货处理。

针对上述 POS 模式的特征,保荐机构与申报会计师已向发行人主要库存芯片的原厂 A 公司和 B 公司进行询证。

A 公司的回复如下:

"A 公司对代理商科通的销售模式是 POS 销售模式,科通用目录价格采购每个物料(PN),科通对最终客户销售时,A 公司按实际采购价格(扣除返利后的价格)与科通进行结算。A 公司物料的目录价格和实际采购价格相差较大,许多目录价格高于实际采购价格 10 倍以上。

科通库存的 A 公司的产品,如果未来市场价格下降,科通会重新向 A 公司

申请实际采购价格,在 A 公司同意后,会调低实际采购价格,保证代理商在销售时的合理利润。

如果科通部分物料长期库存,确定没有终端客户需要,科通可以申请按目录价格,退货给 A 公司。按代理协议,每个季度科通可申请的最高退货金额是上季度科通目录价格采购总额金额的 3.5%。"

B 公司的回复如下:

"B公司对代理商科通的销售模式是 POS 销售模式,科通用目录价格采购物料,科通对最终客户销售时,B公司按实际采购价格与科通进行结算。B公司物料的目录价格和实际采购价格相差 1.7-2 倍。

科通从 B 公司采购物料的库存,如果未来市场价格有变,科通会重新向 B 公司申请实际采购价格,在 B 公司同意后,调整实际采购价格。

如果科通从 B 公司采购物料的库存,确定没有终端客户需要,科通可以申请按目录价格,退货给 B 公司。按代理协议,每个季度科通可申请的最高退货金额是上季度科通目录价格采购总金额的 5%。

以上是 B 公司对代理商的标准政策,对科通技术和其他代理商都是一样的。"

因此,发行人主要采用 POS 模式进行采购销售,POS 商业模式决定了公司的库存芯片不会出现大幅跌价风险,A 公司和 B 公司均对该模式的特征进行了确认。

截至 2023 年 12 月末,2020 年末、2021 年末、2022 年末存货的结转比例高达 99.04%、98.54%和 79.92%,部分 2022 年末存货仍在持续销售。从历史发行人库存期后结转情况来看,发行人各期末存货均实现了较高的期后结转比例,不存在大额滞销风险。综上所述,发行人的商业模式决定其不存在大额滞销或客户退换货的情形。

- (三)结合 2022 年末、2023 年上半年末存货减值测试方式与具体过程等进一步说明发行人计提存货跌价准备的充分性
 - 1、公司与原厂的合作模式不会导致公司存货出现大额跌价风险

芯片原厂主要采用POS模式向发行人销售,POS模式是欧美芯片原厂普遍采用的销售模式,其主要特征如下:

- (1)发行人以目录价格向原厂采购,在实现销售后,原厂以实际采购价与 公司进行结算,目录价格和实际采购价格的差异作为原厂给予发行人的返利;
- (2) 当市场价格波动时,发行人可以与原厂协商采购价格的调整,以保证自身库存芯片不发生大额跌价风险。

其中,当芯片的市场需求旺盛、价格上涨时,市场价格通常高于发行人库存 芯片的成本,库存芯片不存在跌价风险。虽然根据代理协议原厂有权利调整发行 人库存芯片销售时与原厂的实际结算价格,但如果原厂计划调高发行人库存芯片 的实际结算价格,通常会提前通知发行人并向市场传递涨价的预期,发行人会与 客户同步商谈,客户为了避免市场价格上涨通常会加快提货和备货,或接受更高 的销售价格。这种情况下,发行人库存芯片不存在跌价风险。

当芯片市场需求不足、价格下降时,下游客户可能出现推迟提货或要求降低销售价格的情况。这种情况下,发行人会将市场需求信息及价格信息传递给芯片原厂,并向芯片原厂申请调低实际采购价格;芯片原厂为了消化市场库存,通常会接受发行人的申请,调低发行人的实际结算价格,以促进发行人库存芯片的销售。这种情况下,发行人库存芯片也不存在大额跌价风险。

当发行人部分芯片无法向下游销售时,芯片原厂通常会向发行人推荐客户,或按照代理协议允许发行人按照一定比例退货,避免某款芯片在发行人处形成长期呆滞库存。

因此,公司与芯片原厂的合作模式不会导致公司存货出现大额跌价风险。

2、公司存货跌价准备计提方法合理、跌价准备计提充分

(1) 公司存货跌价准备的会计政策

公司各期末均严格按照企业会计准则规定对期末存货采用成本与可变现净值孰低计量。

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于 其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存 货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

2022 年末、2023 年上半年末公司参考期末存货的库龄,并根据市场需求的变化情形以及期后销售情况,考虑是否需要计提跌价准备。

公司存货跌价准备、可变现净值计算过程如下:

存货跌价准备=存货成本-可变现净值

可变现净值=存货的估计售价+存货的预估返利-估计的销售费用-相关税费

(2) 公司存货跌价准备的具体参数确定过程

①存货的估计售价的确认

公司确定存货估计售价的具体方法如下:

- A、对于期末有不可取消订单支撑的存货,以不可取消订单平均价格为预计售价;
- B、对于期末无不可取消订单支撑的存货,取公司最近六个月该商品或类似商品的平均售价为预计售价;
- C、对于少数期末无不可取消订单支撑且六个月内无销售记录的存货,取供应商指导价为预计售价;

D、对于库龄两年以上的长库龄存货,剔除预估返利后全额计提。

保荐机构及申报会计师认为,公司确定存货的估计售价时,优先采用存货对应的不可取消订单的价格;未采用普通订单的价格的主要原因是普通订单不具有强有力的约束力,客户基于行业惯例可以协商变更和取消,不宜用于存货跌价测算。由于在芯片分销行业,芯片的价格通常随行就市,在没有不可取消订单的情况下,公司采用最近六个月的存货销售价格作为跌价测试的参考,该价格最接近跌价测试时点存货的市场价格。因此,公司确定存货估计售价的方法是谨慎的。

②存货的预估返利的确认

公司确定存货估计售价的具体方法如下:

- A、对于不包含返利的存货, 公司不确认预估返利:
- B、对于已销售过并向供应商申报POS获取返利的产品,公司按照最近一次获得的返利,作为该存货的预估返利;
- C、在存在返利的存货中,对于未销售过的新产品,公司向供应商确认该存货中包含的单位返利,并将其作为该存货的预估返利。

保荐机构及申报会计师认为,公司确定存货的预估返利时,充分考虑了存货市场价格上涨/下跌的情况下,供应商调整返利的可能性,因此,优先考虑采用相应型号存货最近一次获得的返利作为预估返利,该预估返利最能反映存货跌价测试时点相应型号存货的可获得返利;对于未销售过的新产品,则向供应商确认该存货中包含的单位返利,并将其作为该存货的预估返利。因此,公司确定存货预估返利的方法是谨慎的。

- ③使用的销售费用率为全年度的销售费用与年度营业收入的比率。
- ④相关税费的税率为全年度发生的税金及附加与营业收入的比率。
- (3)发行人参考不可取消订单作为预计售价的占比较少,主要采用最近的销售价格及返利确定存货的跌价准备

截至2023年6月30日,公司存货跌价准备计提情况按预计售价类别分类及按 预估返利类别分类的情况如下:

类别	细分类别	存货账面余额	占比	跌价准备	比例
	不可取消订单	44,012.33	8.69%	126.81	0.29%
	6个月内平均售价	418,745.76	82.65%	5,123.38	1.22%
接预计售价标 准划分	指导价	42,925.80	8.47%	2,226.57	5.19%
12277	2年以上库龄存货	974.91	0.19%	722.39	74.10%
	合计	506,658.80	100.00%	8,199.15	1.62%
	不存在返利	16,734.91	3.30%	2,677.77	16.00%
按预估返利类 别标准划分	最近一次获得返利	463,370.05	91.46%	4,229.92	0.91%
	向供应商确认返利	26,553.84	5.24%	1,291.46	4.86%
	合计	506,658.80	100.00%	8,199.15	1.62%

A、按预计售价划分的存货跌价准备分析

由上表可知,公司有不可取消订单覆盖的存货占比较低,各期末存货预计售价仍以取6个月内平均售价为主,占比为82.65%。

2023年6月末,公司存货跌价测算取不可取消订单售价为预计售价的金额占比为8.69%,由于不可取消订单具有不可取消、不可撤销的特点,公司预计该类订单能够得到完整执行,因此在测算存货跌价时取该部分订单平均售价为对应存货的预计售价。

2023年6月末,公司采用指导价作为跌价测算预计售价的存货金额占比为 8.47%,占比较小。该部分存货因公司无6个月内销售记录且无法获取有效市场价 格,因此基于谨慎性原则,取供应商公开市场指导价作为跌价测算预计售价。

2023年6月末,公司两年以上存货金额占比较小,存货跌价准备计提金额为722.39万元,跌价计提比例为74.10%。

B、按预估返利划分的存货跌价准备分析

2023年6月末,公司期末存货跌价准备测算预估返利选取标准仍以最近一次 实现销售获得返利为主,占比为91.46%。2023年6月末公司不存在返利的存货占 比较小,占比仅为3.3%,该部分存货采购价格固定,产品利润空间受市场行情影 响较大,因此跌价准备计提比例较高。2023年6月末,公司存在部分新型号产品, 因尚未产生销售记录,因此取供应商确认的返利金额作为存货预估返利,该部分 存货金额占比较小,约为5.24%。 综上,公司在计提存货跌价准备时考虑了各类影响因素,严格按照企业会计准则规定对存货进行减值测试,存货跌价准备的计提具有充分性。

(4) 相比同行业公司,公司存货跌价计提充分

由于在芯片分销行业,芯片的价格通常随行就市,公司的跌价准备参数中,预计售价主要采用最近六个月的存货销售价格作为跌价测试的参考。该价格最接近跌价测试时点存货的市场价格。预估返利的选取主要通过最近一次实现销售获得的返利为主,该部分返利的可实现性最接近市场情况,因此,发行人的主要参数选取是谨慎的。

报告期内,公司基于谨慎性原则,在各期末计提了充分的存货跌价准备。公司扣除返利后的存货金额更能反映公司的真实运营状况,报告期各期末,若扣除预估返利的影响,公司存货跌价计提比例分别为 11.84%、5.07%和 6.27%和 7.94%。

根据同行业可比公司历史平均返利比例,测算扣除预估返利后的存货跌价计提情况如下:

公司简称	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
深圳华强	7.66%	6.17%	3.66%	5.39%
商络电子	10.17%	9.50%	7.53%	6.68%
润欣科技	2.60%	3.08%	4.80%	7.48%
雅创电子	3.69%	2.44%	3.15%	2.20%
好上好	3.59%	3.65%	2.22%	3.07%
中电港	3.68%	3.36%	2.61%	6.47%
可比公司均值	5.23%	4.70%	4.00%	5.22%
可比公司范围	2.60%~10.17%	2.44%~9.50%	2.22%~7.53%	2.20%~7.48%
发行人	7.94%	6.27%	5.07%	11.84%

注:经查询同行业公司公开信息,仅有商络电子、润欣科技和好上好披露过返利金额的情况,因此进行扣除返利模拟测算,其他同行业公司未有返利公开信息,因此未模拟测算

公司扣除返利后的存货金额更能反映公司的真实运营状况,报告期各期末,若扣除预估返利的影响,公司存货跌价计提比例分别为 11.84%、5.07%和 6.27%和 7.94%,高于各期末同行业平均水平。同时,公司将长库龄且没订单覆盖的存货全额计提跌价,跌价准备计提谨慎。

综上所述, 公司存货跌价准备情况计提谨慎、合理、充分。

3、保荐机构及会计师针对发行人存货跌价准备的复核情况

(1) 核查过程

A、保荐机构及申报会计师选取截至 2023 年 6 月 30 日第一大库存供应商前 20 大型号及第二大库存供应商前 5 大型号的报告期内售价和返利波动情况做出 分析性复核,具体样本及核查比例如下:

单位:万元

		截至 2023 年	截至 2022 年	截至 2021 年	截至 2020 年
序号	 型号	6月30日	12月31日	12月31日	12月31日
,,,,	_ `	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
1	*****200T-1FFG1****	30,513.07	11,163.93	12,677.00	-
2	*****P-2FSVA3****	25,633.59	8,955.26	909.24	-
3	*****V-1SFVC****	24,608.74	17,322.12	851.16	149.15
4	******0-1CLG****	22,575.03	23,597.78	7,737.99	49.31
5	******0-2FFVA1****	17,336.60	4,997.14	4,024.06	-
6	******0-1CLG****	16,428.32	8,755.56	105.49	-
7	******0-2FFVA1****	15,708.01	2,177.18	1,107.00	29.90
8	*****G-2FFVC900I****	13,715.54	3,593.56	-	-
9	*****35-2FFVA1****	13,110.94	4,516.40	-	10.02
10	******0T-2FFG****	11,750.90	9,115.78	5,887.54	450.24
11	*****380T-2FFG1****	8,198.25	-	-	-
12	*****5-2FFG****	7,721.46	928.78	1,233.38	85.28
13	*****G-1SFVC****	7,521.72	22,274.36	4.54	-
14	*****V-2SFVC****	7,294.83	-	31.35	1.59
15	*****5T-2FFG****	7,144.34	2,881.43	10,360.67	1,146.45
16	******0-2CLG****	7,037.32	5,087.18	342.29	106.42
17	******0-2FFG****	6,843.64	4,479.82	-	-
18	*****5T-2FFG****	6,400.84	12,460.45	6,402.41	-
19	******0-2FFG****	6,363.95	3,386.70	102.29	59.86
20	******0T-2FBG****	5,726.73	480.36	313.03	568.26
21	*****32A-***	1,644.43	437.22	202.87	108.65
22	******04A-SS****	1,194.55	1,195.76	119.38	0.47
23	*****32-***	895.62	-	-	-
24	*****1N****	764.77	216.32	289.83	23.60

序号	型号	截至 2023 年 6月 30 日 账面余额	截至 2022 年 12 月 31 日 账面余额	截至 2021 年 12 月 31 日 账面余额	截至 2020 年 12 月 31 日 账面余额
25	*****M7X256****	645.43	-	121.59	-
小计(上述	存货合计)	266,778.61	148,023.10	52,823.12	2,789.20
合计(该年	度所有存货合计)	506,658.80	407,964.21	221,066.65	36,104.52
小计/合计		52.65%	36.28%	23.89%	7.73%

针对上述型号样本,执行以下程序:

- ①获取跌价计提明细表,重新计算存货跌价准备的计算过程,检查存货跌价准备计提的合理性;
- ②获取其报告期各期末预计售价、预计返利、期后实际实现的售价(实际售价)、期后实际实现的返利(实际返利),对各数据进行分析性复核,具体如下:

针对第一大库存供应商前 20 大型号:

单位:元

型号1	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
预计售价+预计返利	83,487.39	74,740.00	72,240.67	-
实际售价+实际返利	-	74,755.85	68,482.43	-

复核结论: 2021 年末,期后实际售价+实际返利小于预计售价+预计返利,若用期后实际售价与实际返利进行测算,该存货需要补提存货跌价准备 0.00 万元; 2022 年末,期后实际售价+实际返利大于预计售价+预计返利,存货跌价准备计提充分。

单位:元

型号 2	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
预计售价+预计返利	569,734.97	512,019.63	458,509.86	-
实际售价+实际返利	572,418.08	519,487.86	470,003.92	-

复核结论: 各期末期后实际售价+实际返利大于预计售价+预计返利,存货跌价准备计提充分。

单位:元

型号3	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
预计售价+预计返利	22,736.80	20,202.27	18,618.08	16,055.35
实际售价+实际返利	22,515.85	20,197.47	18,125.93	15,814.07

复核结论:各期末期后实际售价+实际返利均小于预计售价+预计返利,若用期后实际售价与实际返利进行测算,该存货各期末需要补提存货跌价准备 0.00 万元、0.00 万元、0.00 万元、414.06 万元。

单位:元

型号4	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
预计售价+预计返利	1,043.51	959.31	879.12	725.49
实际售价+实际返利	918.40	924.26	836.70	701.92

复核结论: 各期末期后实际售价+实际返利均小于预计售价+预计返利, 若用期后实际售价与实际返利进行测算, 该存货各期末需要补提存货跌价准备 0.00 万元、0.00 万元、0.00 万元、249.46 万元。

单位:元

型号5	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
预计售价+预计返利	29,519.41	27,797.96	26,529.62	-
实际售价+实际返利	31,156.50	28,047.55	25,262.59	-

复核结论: 2021 年末,期后实际售价+实际返利小于预计售价+预计返利,若用期后实际售价与实际返利进行测算,该存货需要补提存货跌价准备 0.00 万元; 2022 年末及 2023 年 6 月末,期后实际售价+实际返利大于预计售价+预计返利,存货跌价准备计提充分。

单位:元

型号6	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
预计售价+预计返利	905.97	795.14	678.24	-
实际售价+实际返利	-	841.97	724.82	-

复核结论: 2021 年末及 2022 年末,期后实际售价+实际返利大于预计售价+预计返利,存货跌价准备计提充分。

单位:元

型号7	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
预计售价+预计返利	18,863.15	16,942.54	16,547.24	11,600.66
实际售价+实际返利	19,252.22	17,266.53	15,795.51	15,279.89

复核结论: 2021 年末,期后实际售价+实际返利小于预计售价+预计返利,若用期后实际售价与实际返利进行测算,该存货需要补提存货跌价准备 0.00 万元; 2020 年末、2022 年末及 2023 年 6 月末,期后实际售价+实际返利大于预计售价+预计返利,存货跌价准备计提充分。

单位:元

型号8	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
预计售价+预计返利	26,844.24	24,522.05	-	-
实际售价+实际返利	27,354.40	24,371.21	-	-

复核结论: 2022 年末,期后实际售价+实际返利小于预计售价+预计返利,若用期后实际售价与实际返利进行测算,该存货需要补提存货跌价准备 0.00 万元; 2023 年 6 月末,期后实际售价+实际返利大于预计售价+预计返利,存货跌价准备计提充分。

单位:元

型号9	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
预计售价+预计返利	14,345.19	13,001.58	-	10,698.79

型号9	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
实际售价+实际返利	14,531.87	12,984.31	-	10,698.79

复核结论: 2022 年末,期后实际售价+实际返利小于预计售价+预计返利,若用期后实际售价与实际返利进行测算,该存货需要补提存货跌价准备 0.00 万元; 2020 年末、2023 年 6 月末,期后实际售价+实际返利不小于预计售价+预计返利,存货跌价准备计提充分。

单位:元

型号 10	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
预计售价+预计返利	26,059.03	23,394.70	21,645.73	14,538.06
实际售价+实际返利	26,254.56	23,471.13	21,383.42	14,551.26

复核结论: 2021 年末,期后实际售价+实际返利小于预计售价+预计返利,若用期后实际售价与实际返利进行测算,该存货需要补提存货跌价准备 0.00 万元; 2020 年末、2022 年末、2023 年 6 月末,期后实际售价+实际返利大于预计售价+预计返利,存货跌价准备计提充分。

单位:元

型号 11	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
预计售价+预计返利	115,631.20	-	-	-
实际售价+实际返利	-	-	-	-
复核结论: 该型号期后暂未产生销售。				

单位:元

型号 12	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
预计售价+预计返利	17,315.33	15,477.86	14,911.19	11,767.54
实际售价+实际返利	17,375.92	15,628.96	14,213.02	12,312.49

复核结论: 2021 年末,期后实际售价+实际返利小于预计售价+预计返利,若用期后实际售价与实际返利进行测算,该存货需要补提存货跌价准备 0.00 万元; 2020 年末、2022 年末、2023 年 6 月末,期后实际售价+实际返利大于预计售价+预计返利,存货跌价准备计提充分。

单位:元

型号 13	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
预计售价+预计返利	6,831.94	6,036.14	4,722.41	-
实际售价+实际返利	6,736.42	6,051.18	4,633.38	-

复核结论: 2021 年末及 2023 年 6 月末,期后实际售价+实际返利小于预计售价+预计返利,若用期后实际售价与实际返利进行测算,该存货需要补提存货跌价准备 0.00 万元、108.23 万元; 2022 年末,期后实际售价+实际返利大于预计售价+预计返利,存货跌价准备计提充分。

单位:元

型号 14	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
预计售价+预计返利	10,328.86	-	6,380.40	7,695.55
实际售价+实际返利	11,512.15	-	7,962.06	8,050.46

型号 14	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
复核结论:各期末期后实际分。	告价+实际返利	大于预计售价+	预计返利,存货路	

单位:元

型号 15	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
预计售价+预计返利	18,086.95	16,183.82	14,766.61	10,591.66
实际售价+实际返利	18,114.22	16,304.69	14,835.15	10,313.70

复核结论: 2020 年末,期后实际售价+实际返利小于预计售价+预计返利,若用期后实际售价与实际返利进行测算,该存货需要补提存货跌价准备 0.00 万元; 2021 年末、2022 年末、2023 年 6 月末期后实际售价+实际返利大于预计售价+预计返利,存货跌价准备计提充分。

单位:元

型号 16	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
预计售价+预计返利	1,166.65	996.32	979.78	781.19
实际售价+实际返利	1,125.74	1,011.13	936.08	927.20

复核结论: 2021 年末及 2023 年 6 月末,期后实际售价+实际返利小于预计售价+预计返利,若用期后实际售价与实际返利进行测算,该存货需要补提存货跌价准备 0.00 万元、60.29 万元; 2020 年末、2022 年末期后实际售价+实际返利大于预计售价+预计返利,存货跌价准备计提充分。

单位:元

型号 17	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
预计售价+预计返利	19,988.72	18,277.82	-	-
实际售价+实际返利	20,993.51	18,457.27	-	-
有块件以 女细士细广应厅	金		ないじてむ ナルロ	此从此友儿相子

复核结论: 各期末期后实际售价+实际返利大于预计售价+预计返利,存货跌价准备计提充分。

单位:元

型号 18	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
预计售价+预计返利	15,853.96	14,060.59	12,865.48	-
实际售价+实际返利	15,700.27	14,106.29	12,904.32	-

复核结论: 2023 年 6 月末,期后实际售价+实际返利小于预计售价+预计返利,若用期后实际售价与实际返利进行测算,该存货需要补提存货跌价准备 98.27 万元; 2021 年末、2022 年末期后实际售价+实际返利大于预计售价+预计返利,存货跌价准备计提充分。

单位:元

型号 19	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
预计售价+预计返利	3,068.81	2,886.77	2,285.17	2,346.97
实际售价+实际返利	3,190.13	2,867.92	2,613.33	2,238.55

型号 19	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
 _				

复核结论: 2020 年末、2022 年末,期后实际售价+实际返利小于预计售价+预计返利,若用期后实际售价与实际返利进行测算,该存货需要补提存货跌价准备 0.00 万元、0.00 万元; 2021 年末、2023 年 6 月末期后实际售价+实际返利大于预计售价+预计返利,存货跌价准备计提充分。

单位:元

型号 20	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
预计售价+预计返利	1,940.90	1,691.85	1,624.37	1,401.63
实际售价+实际返利	1,880.06	1,683.63	1,532.16	1,336.11

复核结论:报告期各期末,期后实际售价+实际返利小于预计售价+预计返利,若用期后实际售价与实际返利进行测算,该存货需要补提存货跌价准备 0.00 万元、0.00 万元、0.00 万元 12.07 万元。

针对第二大库存供应商前5大型号:

单位:元

型号1	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
预计售价+预计返利	22.48	18.82	15.82	16.47
实际售价+实际返利	21.13	19.05	15.83	14.58

复核结论: 2020 年末、2023 年 6 月末,期后实际售价+实际返利小于预计售价+预计返利,若用期后实际售价与实际返利进行测算,该存货需要补提存货跌价准备 0.02 万元、29.03 万元; 2021 年末、2022 年末期后实际售价+实际返利大于预计售价+预计返利,存货跌价准备计提充分。

单位:元

型号 2	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
预计售价+预计返利	2.93	3.54	2.60	2.64
实际售价+实际返利	3.19	3.02	2.51	2.25

复核结论: 2020 年末、2021 年末、2022 年末,期后实际售价+实际返利小于预计售价+预计返利,若用期后实际售价与实际返利进行测算,该存货需要补提存货跌价准备 0.00 万元、0.00 万元、1.97 万元; 2023 年 6 月末期后实际售价+实际返利大于预计售价+预计返利,存货跌价准备计提充分。

单位:元

型号3	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
预计售价+预计返利	36.06	-	-	-
实际售价+实际返利	35.90	-	-	-

复核结论: 2023 年 6 月末,期后实际售价+实际返利小于预计售价+预计返利,若用期后实际售价与实际返利进行测算,该存货需要补提存货跌价准备 17.32 万元

单位:元

型号 4	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
预计售价+预计返利	12.46	11.16	9.92	9.90
实际售价+实际返利	12.94	12.70	9.60	8.45

复核结论: 2020 年末、2021 年末,期后实际售价+实际返利小于预计售价+预计返利,若用期后实际售价与实际返利进行测算,该存货需要补提存货跌价准备 0.02 万元、0.00 万元; 2022 年末、2023 年 6 月末期后实际售价+实际返利大于预计售价+预计返利,存货跌价准备计提充分。

单位:元

型号 5	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
预计售价+预计返利	59.98	-	40.22	-
实际售价+实际返利	61.05	-	48.88	-
有技体队 发期土期后办厅	こと ひ みににて	114 工程11 年 14	ないいにもし ナルロ	此及地友工相去

复核结论:各期末期后实际售价+实际返利大于预计售价+预计返利,存货跌价准备计提充分。

上述复核样本中,实际售价+实际返利低于预计售价+预计返利的部分,部分 样本不需要补提跌价,是因为按照实际金额测算的可变现净值仍大于期末存货账 面余额。汇总上述需要补提存货跌价的金额如下:

单位:万元

项目	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
需补提金额 (测算数据)	988.74	1.97	1	0.49
净利润	12,143.87	30,893.84	31,281.65	15,922.81
需补提金额占利润比例	8.14%	0.01%	0.00%	0.00%
扣除需补提金额后净利润	11,155.13	30,891.87	31,281.65	15,922.32

上述"需补提金额",仅为分析性复核测算金额,且仅考虑实际数据小于预估数据时需补提的部分,未考虑实际数据大于预估数据时多计提的部分。该数据为期后数据,仅用于复核测算存货跌价准备的充分性,不代表资产负债表日用于测算存货跌价的市场数据,发行人报告期财务数据并不因此需要更正。

(2) 核查结论

保荐机构及申报会计师针对截至 2023 年 6 月 30 日第一大库存供应商前 20 大型号及第二大库存供应商前 5 大型号库存进行分析性复核,该等型号的各期期 末存货结余占报告期各期存货总余额的比例为 7.73%、23.89%、36.28%、52.65%。 实际售价和实际返利小于预计售价和预计返利的部分,若使用实际售价和实际返

利进行测算,其需要补提金额较小。

保荐机构及申报会计师认为。发行人的期末存货跌价准备计提谨慎、充分, 不存在大额跌价的风险。

三、中介机构核查程序与核查意见

(一)核查程序

针对上述问题,保荐人和申报会计师主要执行了如下核查程序:

- 1、查阅半导体行业报道、行业研究报告,核实 2023 年上半年半导体行业处于去库存的低迷周期、下游市场需求疲软的相关情况;
- 2、核查我国 2022 年本土已上市/拟上市前十大的电子元器件分销商在 2023 年上半年的行业排位变动情况;
- 3、核查收入成本大表,对发行人产品在各领域的收入情况、毛利率情况、 存量客户、新增客户等进行核对:
- 4、访谈发行人业务相关负责人,了解发行人产品在各领域的收入情况、毛 利率情况变动的原因;
 - 5、核查同行业公司 2023 年 1-6 月的业绩情况;
- 6、查阅发行人下游各应用领域行业研究报告、主要政策情况,核实 2023 年 下半年及未来发行人下游各应用领域的发展趋势;
- 7、获取各期末存货结存明细表和期后销售及退换货情况,统计主要产品线的存货期末账面余额及变动情况,获取存货库龄表,统计公司存货库龄情况,并计算主要产品类型的存货期后销售及退换货情况,确认是否存在大额存货滞销的情况;
- 8、分析公司存货跌价准备计提及可变现净值确认方法的合理性,存货跌价 计提是否充分,复核报告期内存货跌价明细表,抽样重新计算存货跌价准备的计 算过程,检查存货跌价准备计提的合理性和准确性;
- 9、对 2023 年 6 月 30 日大额存货的报告期各期末余额执行分析性复核程序。 报告期各期末,该等存货期后实际售价及实际返利的合计均大于该等存货期末账

面余额。

(二)核査意见

经核查,保荐人、申报会计师认为:

- 1、综合芯片分销行业景气度及竞争状况、产品终端应用领域需求具体变化、发行人毛利率、客户变动以及变动原因等情况,2023 年上半年发行人业绩存在下滑的主要原因为: (1)2023 年上半年,半导体行业仍处于去库存的低迷周期,下游市场需求疲软,造成发行人同期收入下滑; (2)2023 年上半年,工业互联及数字基建的市场需求在持续增长,但由于发行人终端客户的产品需求阶段性得到满足,发行人在工业互联及数字基建领域的收入出现阶段性下降的情况,发行人在工业互联及数字基建领域的收入分别下降了65,582.00万元、12,342.15万元,造成发行人同期收入下滑; (3)2023年上半年,发行人客户数量减少、存量客户收入存在一定程度下滑、增量客户对收入的贡献下降,造成发行人同期收入下滑。
- 2、由于半导体行业仍处于低景气周期,下游市场需求回升疲软,发行人所处的芯片分销行业整体均受此影响。因此,2023年1-6月业绩有所下滑,但变化趋势与同行业可比公司基本相同,无显著差异。
- 3、发行人未来的成长受到宏观经济形势、行业动态、竞争格局、市场开拓能力、技术实力等多重因素的影响,预期前述因素在可预见的时间范围内不会发生重大不利变化,发行人经营业绩进一步下滑的风险较低。
- 4、受 Xilinx 产品具有高定价、高返利的特征及备货力度、产品结构差异、市场需求变动等因素影响,2022 年末、2023 年上半年末存货余额持续大幅增长,具有合理性。
- 5、2022 年末及 2023 年上半年末公司包含预估返利的存货库龄在一年以内的占比分别为 90.79%和 92.88%,期后结转比例分别为 73.69%和 29.05%,2023年上半年末公司存货的订单覆盖率为 80.28%(不可取消订单的覆盖率 8.84%),公司的产品下游订单覆盖情况良好,公司的商业模式决定其不存在存货大额滞销、退换货的情况。
 - 6、公司按照可变现净值和存货账面价值孰低对存货进行计量,按照存货成

本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备并计入当期损益。可变现净值的确定符合企业会计准则的规定,相关计算参数依据是合理、谨慎的。报告期各期末,公司的存货跌价准备计提充分,扣除预估返利的影响,公司存货跌价计提比例高于同行业平均水平。

7、保荐机构及申报会计师针对截至 2023 年 6 月 30 日第一大库存供应商前 20 大型号及第二大库存供应商前 5 大型号库存进行分析性复核,该等型号的各期期末存货结余占报告期各期存货总余额的比例为 7.73%、23.89%、36.28%、52.65%。发行人的期末存货跌价准备计提谨慎、充分,不存在大额跌价的风险。

问题 3. 关于历史股东优车易购(香港)与对赌协议

申报材料及审核问询回复显示:

- (1) 2020年7月, 优车易购(香港)入股发行人25%股份。2020年9月、11月与2022年5月, 优车易购(香港)分三次转让前述股份并退出发行人。优车易购(香港)所得股权转让款共计60,732.45万元,其中19,673.41万元为按照投资协议约定转款给硬蛋创新的款项及保证金;31,691.55万元用于股权投资及理财。
- (2)发行人在引入广东粤财新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)等26名投资人时,发行人、实际控制人康敬伟、控股股东Alphalink、深圳优车易购、优车易购(香港)曾与前述投资人签署了含有特殊权利条款的投资协议,特殊权利条款包含股份回购、优先认购权、随售权、反稀释权等。经各方同意,上述协议于2021年12月31日无条件终止且自始不具有法律约束力。

请发行人:

- (1)结合优车易购(香港)入股发行人前,优车易购(香港)及其实际控制人等相关方与发行人实际控制人、硬蛋创新及其关联方的合作背景、股权及相关人员与主体的关系、协议约定等,进一步说明优车易购(香港)入股发行人后短时间内出让发行人股份,并在发行人本次申报前夕退出发行人的原因及商业合理性。
- (2)说明优车易购(香港)及其相关方出让发行人股权后,按照协议支付至 硬蛋创新的款项及保证金的使用情况及去向,硬蛋创新是否对前述款项进行专项 管理;优车易购(香港)及其相关方将股权转让款购买理财的具体情况,包括但 不限于理财产品类型及到期情况、股权投资标的及到期情况,购买理财产品的真实性;优车易购(香港)及其相关方出让发行人股权所得款是否存在为发行人提供体外资金循环、资金闭环回流等情况。
- (3)说明与外部投资者签订的投资协议中特殊权利条款的具体内容,发行人、实际控制人、控股股东、深圳优车易购、优车易购(香港)依据前述特殊条款需要承担的具体义务;优车易购(香港)依据前述协议将股权转让款支付给硬蛋创新并提供保证金的原因及合理性,其他承诺方提供保证金情况。

请保荐人、发行人律师发表明确意见。

回复:

- 一、结合优车易购(香港)入股发行人前,优车易购(香港)及其实际控制人等相关方与发行人实际控制人、硬蛋创新及其关联方的合作背景、股权及相关人员与主体的关系、协议约定等,进一步说明优车易购(香港)入股发行人后短时间内出让发行人股份,并在发行人本次申报前夕退出发行人的原因及商业合理性
- (一)港股上市公司硬蛋创新(0400.HK)下属业务板块——硬蛋科技发展概况,及优车易购(香港)实际控制人沈兵入股情况

1、硬蛋科技初创探索期

2013年,港股上市公司硬蛋创新(0400.HK)拟孵化硬蛋科技业务板块,初始定位为智能硬件的营销平台。

2013-2014 年,硬蛋科技处于探索期,重点布局智能硬件领域,积极探索多种可变现商业模式,并于 2014 年 10 月,设立了 Hardeggs Holdings Limited,将 Hardeggs Holdings Limited 及其下属企业作为硬蛋科技业务的主要运营主体。

2、硬蛋科技快速发展期及沈兵入股

2015 年,硬蛋科技明确自身战略定位,致力于成为中国领先的智能硬件的 创新创业服务平台,为创新创业企业提供包括供应链、销售渠道、配套服务在内 的全方位服务,形成从概念到产品,从产品到量产,再到销售的服务闭环。该期 间,投资人沈兵向硬蛋创新提出看好硬蛋科技该业务板块的发展前景,有意作为 天使投资人入股硬蛋科技。

投资人沈兵早期由于业务关系认识了康敬伟父亲康钢舰及兄弟康义,并在 1998 年与其父亲及兄弟等人共同创建了重庆松日电机有限公司,此公司已于 1999 年停止经营。后续沈兵个人主要做从事投资工作,同时于 2006 年被聘为原康敬伟控制的美国上市公司 VIEWTRAN 的顾问,协助公司业务开拓,后延续至 其港股上市公司硬蛋创新,2014 年至 2015 年曾经在深圳市前海硬蛋通信技术有限公司及科通数字技术(深圳)任职。

2016年,沈兵以 100 万美元的价格通过其控制的 Optimum Profuse Limited 取得 Hardeggs Holdings Limited 30%股权,对应的整体估值为 333.33 万美元,约为 2,300 万元。沈兵入股 Hardeggs Holdings Limited 后,作为战略股东,发挥其本身资源优势,为硬蛋创新引荐投资者,并导入供应商资源,促成硬蛋科技与智能驾驶供应商的战略合作,以及促成硬蛋科技承办第五届上海创博会、第九届 APEC 中小企业技术交流暨展览会协办方等,并协助在国内开展各区域的硬蛋空间(智能硬件产品展示宣传及体验厅)落地,如北京硬蛋空间、重庆硬蛋空间等。

2016-2017年,硬蛋科技处于快速发展期。该期间,硬蛋科技将企业服务从智能硬件跨界延伸至制造业,并进行全球化扩张,在美国、韩国、日本、以色列、意大利等多国设立分公司、办事处、硬蛋空间,以每个硬蛋空间的物理展示平台为起点,辐射本地及周边国家和地区企业客户。

硬蛋科技作为连接全球创新和中国制造的智能硬件平台,平台上积累了上万个智能硬件项目,与多名知名投资机构达成初步投资意向,并计划在经过几年发展后进行独立分拆上市。

3、硬蛋创新集团业务调整期及与沈兵商治"换股"事宜

2017 年 5 月,烽火研究发布了针对硬蛋创新的做空报告。受此影响,硬蛋创新股价大幅下跌,整体资金紧张,致使硬蛋创新在短期内难以重点发展硬蛋科技这类需大量资金投入的业务。

基于此,硬蛋创新调整集团发展策略,优化业务结构,拟将硬蛋科技的战略定位由"智能硬件的创新创业服务平台"调整为"定制化模块及解决方案、开发及销售自研 AIOT 产品业务",且不再大规模投入资金;同时,硬蛋创新将业务重心转移到自身优势业务芯片授权分销业务,并于 2019 年完成发行人的业务重组。

为了更加灵活地发展硬蛋科技业务,硬蛋创新拟将 Hardeggs Holdings Limited 变更为全资子公司,但当时自身资金较为紧张,所以拟以同等价值的资产互换的方式收购沈兵间接持有的 Hardeggs Holdings Limited 的少数股权,与此同时硬蛋创新计划将发行人分拆至 A 股上市。

在上述背景下,考虑到未来投资退出的便利性,以及亦看好芯片应用设计和 分销服务业务的未来发展,沈兵与硬蛋创新协商"换股"具体方案。

(二) 沈兵以"换股"方式持股发行人

1、2019年达成"换股"交易安排

2019 年初,硬蛋创新拟将集团业务发展重心转移到发行人,将旗下的芯片分销业务整合至发行人,拟分拆发行人至 A 股上市。基于硬蛋创新发展重心调整至发行人,且拟分拆上市主体从 Hardeggs Holdings Limited 调整为发行人,同时沈兵看好芯片分销行业的发展前景。经与硬蛋创新协商,双方达成了关于"换股"事宜的意向方案。

2019年12月17日,境外评估机构 Trinity Corporate Finance Limited 出具的评估报告显示,以2019年6月30日为评估基准日,Hardeggs Holdings Limited 30%股权估值约为8,836.50万元,科通工业25%股权估值约为8,750.25万元。发行人2019年1-6月未经审计净利润为1,470万元,参考港股和美股同行业上市公司的估值水平,发行人整体估值为35,001万元,对应年化市盈率为11.91倍; Hardeggs Holdings Limited 30%股权估值约为8,836.50万元人民币,对应整体估值为29,455万元。

基于上述评估基础,并经双方协商一致,同意发行人 25%股权估值等同 Hardeggs Holdings Limited 30%股权估值,以此进行"换股"交易。

本次交易中,发行人估值的合理性分析如下:

2019 年发行人间接控股股东硬蛋创新受到烽火研究事件、业绩下滑等事项的影响在港股的估值较低,2018 年和2019 年硬蛋创新具体数据如下:

项目	2018年		2019年	
	平均	最低	平均	最低
市盈率 (倍)	12.92	8.97	13.95	6.64
股价(港元/股)	3.52	2.46	2.14	1.25
市值 (亿港元)	51.72	36.34	31.10	17.84

Trinity Corporate Finance Limited 评估报告参考同行业上市公司估值水平给 予发行人的市盈率为 11.91 倍,并未明显低于发行人间接控股股东硬蛋创新同时

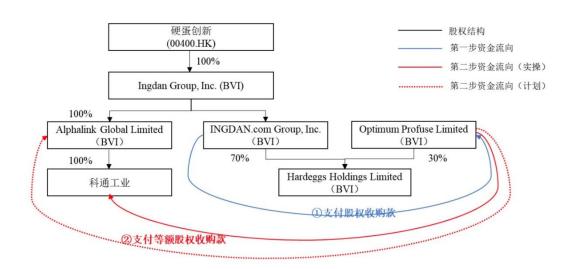
期在港股的平均市盈率, 具备合理性。

2、发行人需增资以发展业务,为简化"换股"及增资交易,经协商调整整体交易方案

本次交易前,硬蛋创新通过 Alphalink 持有发行人 100%股权,发行人需要资金发展业务,硬蛋创新原计划由 Alphalink 以科通工业净资产作价向其增资 25%,增资金额 3500 万元。

根据原计划方案,本次"换股"正常步骤应为:先由Alphalink以科通工业净资产为作价增资3,500万元取得科通工业25%的股权,而后Alphalink再将其所持有科通有限25%股权与将Optimum Profuse Limited所持有的30%的Hardeggs Holdings Limited 30%股权进行"换股"。

交易各方为了尽快完成交易简化了"换股"及增资流程,经各方协商一致,将 Optimum Profuse Limited 从 Alphalink 收购其持有的科通工业 25%股权的交易方式调整为由 Optimum Profuse Limited 直接向科通工业增资,而 Alphalink 放弃原应取得的股权转让款项及向发行人增资的权利,转由发行人直接取得 Optimum Profuse Limited 的增资款项。具体如下图所示:



因此,各方协商一致,以科通工业 2019 年末预计净资产 10,155.05 万元为基础,优车易购(香港)向科通工业增资获得 25%股权计算,增资额为 3,385.02 万元,经各方协商确定,最终增资作价确定为 3,500 万元。

硬蛋创新(0400.HK)董事会已于2019年12月决议通过,上述优车易购(香

港)"换股"及增资方案所涉买卖协议及意向书各自之条款属公平合理,且买卖协议及意向书各自按一般商业条款进行,符合硬蛋创新及其股东之整体利益。 2019年12月17日,硬蛋创新发布了《有关收购硬蛋余下之30%股权及认购科通工业深圳之25%股权》之公告,对上述交易方案进行了详细披露。

上述交易方案,对相关方的影响如下:

对于硬蛋创新而言,无论选择以评估值 8,750.25 万元进行换股交易,或以净资产 3,385.02 万元进行换股交易,其整体现金流净额均未产生变化。

对于 Optimum Profuse Limited 而言,本次交易中其已支付公允对价,以所持 Hardeggs Holdings Limited 30%股份换取等价值发行人股权,不存在 Optimum Profuse Limited 损害发行人或其控股股东利益的情形。

对于发行人而言,其股东层面的资本运作实际可以看作控股股东 Alphalink 先以净资产作价进行增资后,将获得的 25%的股权转让给 Optimum Profuse Limited,仅是在实操层面方便操作,由 Optimum Profuse Limited 直接将款项支付给发行人,因此不存在损害发行人利益的情形。同时,彼时发行人作为 Alphalink 全资控股子公司, Alphalink 以净资产向发行人增资不存在损害其他股东利益的情形。

3、因人员流动限制延后至 2020 年办理完毕工商变更登记

2019年12月17日,Optimum Profuse Limited 与硬蛋创新签署意向书,进一步明确具体方案及价格,即由 INGDAN.com Group, Inc.以 3,500 万元价格收购 Optimum Profuse Limited 所持 Hardeggs Holdings Limited 30%股权,Optimum Profuse Limited 指定主体优车易购(香港)以 3,500 万元认购发行人 25%股权的入股方案。而由于受到人员流动限制影响,优车易购(香港)设立、FDI 手续办理等事项进度缓慢,本次增资入股的工商手续于 2020 年 7 月才办理完毕,因此与最初双方协商定价时间间隔较长。

(三) 优车易购(香港)转让发行人股权,实现投资退出

1、沈兵向外部投资机构、发行人员工持股平台转让发行人股权

2020年,国内半导体市场发生较大变化,由于人员流动限制及国际贸易摩

擦等的影响,导致市场普遍"缺芯",国内半导体投资非常活跃。根据半导体行业观察统计数据,2020年芯片企业单笔最高融资额近40亿人民币,总融资额超500亿元,融资企业数量与总金额均达2019年的两倍以上。随着投资的活跃,半导体产业的估值也呈现上涨趋势,以中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI)为例,由2019年12月31日的4,486.02点上升至2020年12月31日的6,501.68点,增长率高达44.93%。

发行人作为众多高端芯片品牌的授权代理商,受益于下游需求的推动,全年业绩大幅增长。发行人在 2020 年启动对外股权融资,硬蛋创新承诺发行人 2020 年全年净利润不低于 1.6 亿元,经各方协商一致,参考国内同行业上市公司的估值水平,并考虑到一级市场融资的流动性折价等因素,最终以 15 倍市盈率作为定价依据,整体估值为 24 亿元。

沈兵控制的优车易购(香港)在该阶段减持发行人股份的原因:

(1) 发行人现阶段预设的增资规模已达上限,不希望投资者继续增资

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 14.33 条的规定,港股上市公司硬蛋创新如进行出售、收购事项的交易金额达到其当时在香港联交所市值的 25%或以上,则构成主要交易,硬蛋创新应召开股东大会审议通过。针对发行人股权融资事项,考虑到发行人与投资机构约定了回购条款,基于谨慎性原则及香港联交所的监管理念,硬蛋创新则按照触发回购后的回购金额计算是否触发前述规则。

在本次沈兵转让股权前,发行人已累计获得了 3.769 亿元的增资,因相关投资者与发行人就增资事宜约定了回购安排,若触发回购条件且相关投资者均行使回购权,发行人按最晚支付回购款时间测算需支付回购款 4.521 亿元,已接近发行人据硬蛋创新当时市值 25%测算的交易规模上限 4.685 亿元。若发行人继续接受投资机构的增资款,则硬蛋创新需要召开股东大会。

考虑到硬蛋创新此时所持有发行人股份已降低至 65.65%,为便捷完成本次融资,且尽可能减少股权稀释及确保控股地位,发行人将本次融资规模控制在 3.769 亿元,根据前述规则无需召开股东大会审议。

在发行人满足融资需求后,仍有多家投资机构希望入股,且表达了可以通过

承接老股的方式入股;同时发行人拟实施员工持股计划,因此与沈兵协商,希望 优车易购(香港)可以出售部分发行人股份。

(2) 发行人估值已达沈兵收益预期,同意出售部分股份变现

如上文所述, 沈兵于 2016 年按照 2,300 万元的估值取得 Hardeggs Holdings Limited 股权, 后又于 2019 年按照约 3.5 亿元估值"换股"取得发行人股份, 而在发行人本次融资中, 发行人估值已达 24 亿元, 因此沈兵认为其对发行人的投资收益已达心理预期, 同意出售部分发行人股份以变现。同时, 深圳一村同盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、江苏疌泉太湖国联新兴成长产业投资企业(有限合伙)、温润振信壹号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、横琴齐创共享股权投资基金合伙企业(有限合伙)、广东博资同泽一号股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳威景同瑞投资中心(有限合伙)等6家外部机构看好发行人未来发展前景, 具备较强的行业竞争力, 因此拟入股发行人。

(3)发行人拟实施员工持股计划,各方协商按外部投资者入股价格受让老 股

为进一步激发核心员工积极性,以推进发行人业务进一步发展,发行人在本次融资时拟同步实施员工持股计划,但此时发行人融资已接近融资上限。此外,如采用硬蛋创新转让发行人老股的方式实施员工持股计划,将稀释硬蛋创新持有发行人的股权比例。因此,硬蛋创新与沈兵协商,由员工持股平台与沈兵沟通按照外部投资者入股的价格承接其持有的部分发行人股权。

鉴于优车易购(香港)为境外股东,而上述6家外部机构均在中国境内,无外币账户,若由优车易购(香港)直接进行转让,受让方需先开立外币账户进行

对价支付,手续较为繁琐。基于交易便利考虑,优车易购(香港)将其持有的发行人股权先转让予沈兵同一控制下的境内主体深圳优车易购,再由深圳优车易购转让予相关受让方,因此两次股权转让数量及价格一致。

2、沈兵向发行人控股股东转让其剩余的发行人股权

2021年6月,发行人进行新一轮融资,广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙)以29元/股的价格,认购发行人新增股份517.2413万股,对应发行人整体估值为29亿元。

2021 年下半年,基于沈兵个人资金需求及投资安排,以及考虑投资发行人的获益已超预期且发行人上市具有不确定性且锁定期太长,沈兵有意向进一步减持发行人股权获利,并与硬蛋创新及发行人协商退出事宜。

硬蛋创新作为发行人间接控股股东,持续看好发行人发展,并拟进一步扩大 持股比例,因此同意由其下属企业、发行人直接控股股东 Alphalink Global Limited 收购沈兵通过优车易购(香港)持有的发行人股权。

但鉴于 2021 年 5 月变更为股份公司后,发起人一年内不得转让其持有的股份,因此交易双方于 2022 年股份公司成立满一年后进行转让,转让价格参照 2021 年发行人增资价格。

2022年5月30日,优车易购(香港)与 Alphalink Global Limited 签署《股权转让协议书》,约定由优车易购(香港)将其持有的发行人 464.7743 万股份以每股价格 29.00 元人民币转让给 Alphalink Global Limited,合计股权转让价款为 13,478.4547 万元。2022年7月6日,Alphalink Global Limited 已支付完毕全部股权转让款。本次股权转让完成后,优车易购(香港)已不再系发行人股东。

二、说明优车易购(香港)及其相关方出让发行人股权后,按照协议支付至硬蛋创新的款项及保证金的使用情况及去向,硬蛋创新是否对前述款项进行专项管理;优车易购(香港)及其相关方将股权转让款购买理财的具体情况,包括但不限于理财产品类型及到期情况、股权投资标的及到期情况,购买理财产品的真实性;优车易购(香港)及其相关方出让发行人股权所得款是否存在为发行人提供体外资金循环、资金闭环回流等情况

(一) 优车易购(香港)及其相关方出让发行人股权收到资金及去向情况 优车易购(香港)历次减持收到的资金情况如下:

时间	减持情况	所获金额(万元)
2020年9月	向发行人员工持股平台转让发行人股权	23,520.00
2020年11月	向一村同盛等 PE 机构转让发行人股权	23,734.00
2022年5月	向发行人直接控股股东 Alphalink (BVI) 转让发行人股权	13,478.45
	60,732.45	

经查阅优车易购(香港)及深圳优车易购银行流水,优车易购(香港)/深圳优车易购上述减持资金主要用途如下:

用途	优车易购(香港)/深圳优车易购 流出金额(万元)
1 按照投资协议约定转款给硬蛋创新及保证金	19,673.41
1.1 按照投资协议约定转款给硬蛋创新	17,632.41
1.2 保证金	4,026.00
1.3 硬蛋创新指定还款(保证金退款)	-1,985.00
2 投资及理财	31,691.55
2.1 公司理财	31,191.55
2.2 股权投资	500.00
3 税款	5,834.66
4 日常支出、租金、借款等	3,532.84
4.1 借款	2,800.00
4.2 日常支出、租金等	732.83
合计	60,732.45

注: 上述数据部分以美元折合人民币估算。

(二)按照协议支付至硬蛋创新的款项及保证金的使用情况及去向,以及 对前述款项的专项管理情况

1、按照投资协议约定转款给硬蛋创新

如上所述,2020年11月,深圳优车易购向深圳一村同盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、江苏疌泉太湖国联新兴成长产业投资企业(有限合伙)、温润振信壹号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、横琴齐创共享股权投资基金合伙企业(有限合伙)、广东博资同泽一号股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳威景同瑞投资中心(有限合伙)转让其所持发行人股权,其中,向深圳一村同盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)等4家投资机构转让发行人7.55%的股权,购买对价为20,710.00万元。该4家投资机构为把控投资风险,避免发行人未成功上市而转让方丧失或不履行回购股权承诺,因此约定将股权转让款借款至发行人,满足发行人的资金需求。根据投资人与转让方达成的《有关科通工业技术(深圳)有限公司之股权转让协议》,条款约定具体如下:"各方同意,原小股东通过本次股权转让所得款项,将以不超过8%/年的成本,借给公司(或其控股的下属公司)用于日常运营、业务拓展及投资者认可的其他用途。"

后续实操中,基于规范发行人与关联方资金往来等合规性的考量,以及考虑到对投资机构权益的保证,最终与投资人协商将此部分转让款转至硬蛋创新。

截至 2021 年末, 沈兵控制的优车易购(香港)及深圳优车易购依据约定向 硬蛋创新合计转账 17,632.41 万元, 系基于发行人合规性考虑及投资人权益保证, 并已取得投资机构认可, 具备合理性。

根据相关投资机构出具的《深圳市科通技术股份有限公司股东确认函》:"本公司知悉并同意,深圳市优车易购科技有限公司已将相关股权转让款项借至硬蛋创新及其附属子公司;各方不存在纠纷或潜在纠纷。"

2、保证金及保证金退款

2021年12月,发行人、实际控制人、深圳优车易购与深圳一村同盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)等投资机构签署了《有关科通工业技术(深圳)有限公司之股权转让协议之补充协议》,除实际控制人、深圳优车易购承担的回购义务之外,原股权转让协议相关的其他特殊安排条款已终止且自始无效;根据《股

权转让协议之补充协议》,如发行人就上市事宜向证券交易所递交的申请材料主动或被动撤回的、发行人本次上市申请被证券交易所或中国证监会否决等情形,则投资者有权要求原股东深圳优车易购按照原股权协议约定承担相应回购义务,同时发行人实际控制人就原股东深圳优车易购回购义务承担连带责任。

为按照投资机构要求就原股东深圳优车易购回购义务承担连带责任,实际控制人基于承担担保责任的风险考量,经与优车易购(香港)及深圳优车易购协商一致,2022年1月优车易购(香港)将自有资金600万美元(折约4,026.00万元人民币)转至实际控制人控制的硬蛋创新作为保证金。2022年5月,由于深圳优车易购存在资金需求,且瑞信杰创拟偿还对硬蛋创新的借款,经各方协商一致,硬蛋创新通过瑞信杰创向深圳优车易购退还了部分保证金1,985.00万元。

基于实际控制人本身权益考量,优车易购(香港)向硬蛋创新提供一定金额作为保证金,以确保发行人实际控制人可以为深圳优车易购的回购义务承担连带责任,优车易购(香港)支付该等保证金的安排具备合理性。除优车易购(香港)外,不存在其他承诺方提供保证金的情况。

3、硬蛋创新获取上述款项后的用途及专项管理情况

经查阅报告期内硬蛋创新(0400.HK)的银行流水,其不存在使用沈兵支付的上述款项用于支持发行人客户、供应商的情形。关于硬蛋创新(0400.HK)的银行流水详细的核查过程及结论,已在首轮问询回复之"28. 关于资金流水核查"以及第二轮问询回复之"11. 关于经营活动现金流量与资金流水"中进行披露。

硬蛋创新收取上述投资协议约定转款给硬蛋创新及保证金后,未对前述款项进行专项管理,上述合计 19,673.41 万元款项用于日常营运资金,最终主要支付予硬蛋创新供应商。

(三)优车易购(香港)及其相关方将股权转让款购买理财的具体情况,包括但不限于理财产品类型及到期情况、股权投资标的及到期情况,购买理财产品的真实性

优车易购(香港)/深圳优车易购获取上述股权转让款后,优车易购(香港)使用 31,191.55 万元人民币(等值 4,835.00 万美元)进行了公司理财,具体为购买了境外私募股权基金份额,所购买的理财产品,均为境外私募股权基金份额,

该等私募股权投资基金主要投向海外能源、生物医疗、人工智能、AIOT等前沿科技领域的企业。基金运营期限7至8年,截至本落实函回复出具日,该等公司理财均未到期。此外,深圳优车易购使用500.00万元向一家公司进行了股权投资,该股权投资未设定投资期限,截至本落实函回复出具日,深圳优车易购未退出该等股权投资。

上述理财、投资系优车易购(香港)/深圳优车易购基于其自身资产增值需要,按照相关投资协议进行的理财、投资,具备真实性。

综上所述,优车易购(香港)历次减持资金主要用于按照投资协议约定转款 给硬蛋创新、投资理财及税款,不存在其他特殊安排。

(四)优车易购(香港)及其相关方出让发行人股权所得款是否存在为发 行人提供体外资金循环、资金闭环回流等情况

根据报告期内沈兵个人以及其控制的优车易购(香港)、深圳优车易购的银行流水,发行人仅存在一家客户、供应商瑞信杰创(报告期各期,发行人向瑞信杰创销售金额分别为 3,960.99 万元、2,041.35 万元和 0 万元,向瑞信杰创采购金额分别为 417.50 万元、577.86 万元及 0 万元,占发行人销售、采购金额比例均较低,瑞信杰创为发行人非主要客户、供应商,且已于 2022 年 6 月注销)与沈兵个人以及其控制的优车易购(香港)、深圳优车易购存在借贷往来,除此之外,沈兵个人以及其控制的优车易购(香港)、深圳优车易购与发行人客户、供应商不存在其它资金往来。

因此,不存在优车易购(香港)及其相关方出让发行人股权所得款为发行人 提供体外资金循环、资金闭环回流等情况。

关于沈兵以及其控制的优车易购(香港)、深圳优车易购与瑞信杰创的资金往来情况,已在第二轮问询回复之"4.关于历史沿革"中进行披露。

- 三、说明与外部投资者签订的投资协议中特殊权利条款的具体内容,发行人、实际控制人、控股股东、深圳优车易购、优车易购(香港)依据前述特殊条款需要承担的具体义务;优车易购(香港)依据前述协议将股权转让款支付给硬蛋创新并提供保证金的原因及合理性,其他承诺方提供保证金情况
- (一)优车易购(香港)/深圳优车易购与外部投资者签订的投资协议中特殊权利条款的具体内容,以及发行人、实际控制人、控股股东、深圳优车易购、优车易购(香港)依据前述特殊条款需要承担的具体义务

2020年11月,深圳市优车易购向深圳一村同盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、江苏疌泉太湖国联新兴成长产业投资企业(有限合伙)、温润振信壹号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、横琴齐创共享股权投资基金合伙企业(有限合伙)、广东博资同泽一号股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳威景同瑞投资中心(有限合伙)转让其从优车易购(香港)处受让的发行人股权。

就上述股权转让事项,发行人(在《股权转让协议》被称为"公司")、实际控制人康敬伟、深圳市优车易购科技有限公司(在《股权转让协议》被称为"原小股东")分别与上述 6 名投资者就股权转让事宜签署了《股权转让协议》(含有特殊条款的协议),《股权转让协议》约定的主要特殊条款需要承担的具体义务如下:

序号	特殊权利条款	协议相关方需要承担的具体义务
1	股权转让价款 限制 ¹	各方同意, 原小股东 通过本次股权转让所得款项,将以不超过 8%/年的成本,借给公司(或其控股的下属公司)用于日常运营、业务拓展及投资者认可的其他用途。在 原小股东 所承担的本协议第 8.7 条回购权、8.8 条现金补偿的义务全部履行完毕或者相应义务全部解除前, 原小股东 不得要求公司,且公司不得主动归还该等借款。在 原小股东 所承担的本协议第 8.7 条、8.8 条的义务全部履行完毕或者相应义务全部解除前,公司将相应款项归还或变相归还(包括但不限于以拆借、往来、为 原小股东 提供融资担保等方式)给 原小股东 ,视同公司及 原小股东 严重违约, 原小股东 需要在被发现该等情况后 10 个工作日内将相应款项归还给公司,并按照违规收回金额的 8%作为违约金支付给投资者;实际控制人对此承担连带保证责任。尽管存在前述约定,若 原小股东 和/或实际控制人被投资者要求履行本协议第 2.2.3 款、第 8.7 款和/或第 8.8 款的义务,则 原小股东 和/或实际控制人有权要求公司向 原小股东 归还该等借款,且将该笔款项仅用于履行

 $^{^1}$ 该条款在与温润振信壹号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、横琴齐创共享股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订的《股权转让协议》不涉及。

序号	特殊权利条款	协议相关方需要承担的具体义务		
		第 2.2.3 款、第 8.7 款和/或第 8.8 款的义务。		
2	优先认购权	公司计划新增注册资本或发行购买公司新增注册资本、认购权和认股权、可转换为公司新增股权的任何证券(以上合称为"新增股权")时,投资者有权(但非义务)按照其届时所持有的公司股权比例认购新增股权("优先认购权")。但优先认购权的行使应受限于公司之母公司硬蛋创新满足香港上市规则的有关要求(如适用)。		
3	优先购买权和 随售权	如实际控制人拟向任何主体("购买方")直接或间接出售或以其他方式处置其持有的全部或部分公司股权,且购买方已经给出具有法律约束力的要约,则投资者享有下列选择权: (1)投资者有权(但无义务)根据实际控制人计划出售的同样条款和条件按其持有之公司股权的相对比例购买实际控制人拟向购买方出售或以其他方式处置的全部或部分权益("优先购买权")。(2)投资者有权随同作为实际控制人一起按同等条件向拟受让方转让该投资方所持有的公司部分或全部股权("随售权")。		
4	反稀释	如届时 投资者 同意新增股权的每一元注册资本(或每股)认缴价格低于根据本协议所约定的本次投资者认缴公司每一元新增注册资本(或每股)的价格,则 公司、实际控制人 应当采取以下一项或多项措施以弥补投资者,并使投资者根据本协议所实际支付的每一元注册资本(或每股)认购价格不高于新增股权的每一元注册资本(或每股)认购价格,该等措施包括但不限于:(a)在中国法律和其它可适用的法律及上市规则允许的前提下,以低于新增股权每一元注册资本(或每股)认购价格的对价向投资者发行新的股权;(b)在中国法律和其它可适用的法律及上市规则允许的前提下,实际控制人以名义对价将其间接持有的公司股权转让给投资者;(c)公司以现金形式补偿投资者;以及(d)中国法律和其它可适用的法律及上市规则允许的其他安排。		
5	知情权	在投资者持有公司股权期间, 公司 应当、并且 实际控制人、上市公司、 控股股东 应当促使 公司 向 投资者 交付相关财务报表、经营等相关资料		
6	回购权	在以下任一事项发生时,投资者有权要求原小股东回购投资者所持有的全部公司股权,且实际控制人对于原小股东的回购义务承担连带保证责任: (i)实际控制人丧失对公司的控制权; (ii)公司和/或实际控制人出现重大诚信问题,包括但不限于:出现投资者不知情的公司账外现金销售收入或超过人民币 100 万元的账外负债,实际控制人、上市公司、控股股东及关联方非经营性占用公司人民币 100 万元以上资金等; (iii)公司、实际控制人、控股股东因从事严重违法行为受到重大行政处罚、被公安机关或检察机关立案侦查; (iv)公司在 2023 年 12 月 31 日之前未能在中国上海证券交易所、深圳证券交易所或投资者同意的其他国家或地区知名证券交易所上市或挂牌,实现首次公开发行股票(其中香港证券交易所限于主板,以收到监管部门或证券交易所核准公开发行股票的批复为准),但因不可抗力导致公司未能如期上市的情况除外。 (v)公司、控股股东、原小股东、实际控制人或受其控制或影响的关联方通过虚假交易、关联交易、放弃债权、不当承认债务等方式转移公司资产; (vi)公司被托管或进入清算或进入破产程序; (vii)公司出现重大诉讼且终审败诉(标的金额超过单笔人民币 3000万元或对业务有重大不利影响),对公司 IPO 构成实质性法律障碍;		

序号	特殊权利条款	协议相关方需要承担的具体义务
		(viii)公司生产经营活动已连续停止达6个月或在任一会计年度内累计停止生产经营达6个月; (ix)在投资者持有公司股权期间,公司一个会计年度的净利润或主营业务收入比上一会计年度下降50%以上; (x)公司其他股东要求行使其享有的对公司股权的回购权或赎回权; (xi)本协议约定的其他回购情形。
7	现金补偿	公司承诺,根据 2020 年经审计的财务报表扣除非经常性损益后当年的净利润不低于 1.6 亿元人民币,若未完成承诺业绩, 投资者 有权要求 原小股东 进行现金补偿及支付违约金, 实际控制人 对此承担连带保证责任
8	优先清算权	于交割日后,如公司发生清算、解散或者关闭等法定清算事由,在对处分公司的资产所得的收益在根据适用法律规定支付全部应付费用和金额后的剩余可分配财产进行分配时, 投资者 有权优先于本次增资前工商登记在册的原股东("原股东")获得等同于按照下述公式计算得出之金额("优先清算金额")的财产分配
9	违约责任	公司、控股股东、实际控制人和原小股东向投资者赔偿因其违反本协议 项下的任何陈述、保证、承诺、约定或义务而给投资者造成的损失(除本协议对相关违约责任另有明确约定之外,公司、控股股东、实际控制人和原小股东构成违约的,应赔偿投资者实际遭受的损失以及为追偿损失而支付的合理费用包括但不限于律师费、财产保全费等)
10	投资者特别权利的中止或终止	投资者在此确认并同意,除本协议另有规定的情形外,为使公司顺利实现首次公开发行之目的,其于本协议项下的相关权利,包括第 8.1 条约定的优先认购权、第 8.2 条约定的实际控制人转股限制、第 8.4 条约定的优先购买权和随售权、第 8.5 条约定的反稀释、第 8.6 条约定的知情权、第 8.7 条约定的回购权、第 8.9 条约定的优先清算权以及任何其他可能构成公司的首次公开发行的法律障碍或对上述进程造成任何不利影响的条款,于公司收到中国证券监督管理委员会、证券交易所或境外其他证券发行监管部门(根据情形适用)、证券交易所的就首次公开发行发出的受理通知之日自动中止或终止,或根据届时上市中介机构的意见协商提前中止或终止(视届时相关监管部门、证券交易所或上市中介机构的意见而定)。若中国证券监督管理委员会、证券交易所或上市中介机构的意见而定)。若中国证券监督管理委员会、证券交易所或上市中介机构的意见,当社会工资,或上市中介机构的意见,有必要,投资者将与本协议除投资者以外的其它各方签署该等条款的终止协议。在中止或终止的情况下,若公司暂停或放弃上市申请、上市申请被否决或公司撤回上市申报材料,或在本协议第 8.7.1 条约定的时间内未能完成合格上市,在首次公开发行申请暂停、被撤回、失效、否决或期限届满而自动恢复时,前述中止或终止自动丧失效力,应该视为该等权利自始存在;中止或终止期间本协议项下的相应权益具有追溯力。
11	最惠待遇	公司、实际控制人及原小股东共同承诺,如果公司、实际控制人及原小股东此后授予任何其他投资者或股东的任何权利、特权或保护比授予投资者的任何权利、特权或保护更为优惠,投资者将有权选择获得与其他投资者或股东享有的权利、特权或保护同等的权利、特权或保护。
12	确保投资者所 持股票禁售期 不被延长	卤类甲氧基6个月层进行 - 确保投资考按监排行 A 腔 IP() 发行从上由期

就上述《股权转让协议》约定的相关股东特殊权利条款,发行人、深圳市优车易购、康敬伟与上述 6 名投资者于 2021 年 12 月 30 日均对应签署了《<股权转让协议>之补充协议》予以清理,主要条款清理情况如下:

序号	特殊权利条款	清理的情况
1	股权转让价款限制	无条件终止,且自始无效并对各方自始不具有法律效力
2	优先认购权	无条件终止,且自始无效并对各方自始不具有法律效力
3	优先购买权和随售权	无条件终止,且自始无效并对各方自始不具有法律效力
4	反稀释	无条件终止,且自始无效并对各方自始不具有法律效力
5	知情权	无条件终止,且自始无效并对各方自始不具有法律效力
6	回购权	变更为: 无条件终止,且自始无效并对各方自始不具有法律效力,但如公司发生以下任意情形之一的(以较早发生的为准),投资方在《增资协议》或《股权转让协议》第 8.7 款回购权中对原股东深圳市优车易购科技有限公司和实际控制人的权利恢复: A.公司主动或被动撤回本次上市申报材料; B.公司本次上市申请被证券交易所或中国证券监督管理委员会否决; C.该补充协议生效后直至 2022 年 12 月 31 日,公司仍未向证券交易所/中国证券监督管理委员会提交本次上市申请; D.发生对公司本次上市产生实质阻碍的其它事件,导致可以预见公司无法实现本次上市。上述"本次上市"指经公司股东大会审议通过的,公司在中国境内的证券交易所首次公开发行股票(不包含在全国中小企业股份转让系统即新三板、北京证券交易所的公开发行)。
7	现金补偿	无条件终止,且自始无效并对各方自始不具有法律效力
8	优先清算权	无条件终止,且自始无效并对各方自始不具有法律效力
9	违约责任	终止关于公司的违约责任及其对其他方的连带责任
10	投资者特别权利的中 止或终止	无条件终止,且自始无效并对各方自始不具有法律效力
11	最惠待遇	无条件终止,且自始无效并对各方自始不具有法律效力
12	确保投资者所持有股 票禁售期不被延长	无条件终止,且自始无效并对各方自始不具有法律效力

截至本落实函回复出具日,除股权回购条款终止附有效力恢复条款外,投资协议所涉其他特殊安排条款均已终止。

(二)优车易购(香港)依据前述协议将股权转让款支付给硬蛋创新并提供保证金的原因及合理性,其他承诺方提供保证金情况

2021年12月,发行人、深圳市优车易购科技有限公司、康敬伟与上述6名 投资机构签订《<股权转让协议>之补充协议》,该协议中约定如发行人就上市事

宜向证券交易所递交的申请材料主动或被动撤回的、发行人本次上市申请被证券 交易所或中国证监会否决等情形,则 6 名投资机构有权要求恢复原股权转让协议 的回购权,即原股东深圳市优车易购科技有限公司按照原股权转让协议约定承担 回购义务且发行人实际控制人康敬伟就原股东深圳市优车易购科技有限公司的 回购义务承担连带保证责任。为按照投资机构要求为原股东深圳市优车易购科技有限公司的回购义务承担连带保证责任,基于实际控制人本身权益考量及确保深 圳市优车易购科技有限公司能够按照约定履行回购义务,实际控制人要求优车易购(香港)向硬蛋创新提供一定金额作为保证金作实际控制人为深圳市优车易购科技有限公司提供连带保证责任的履约保证金,该等安排具备合理性。此外,除 优车易购(香港)外,其他承诺方未提供保证金。

四、中介机构核查程序与核查意见

(一) 核查程序

针对上述问题,保荐人、发行人律师主要执行了如下核查程序:

- 1、查阅了发行人工商内档资料、历次验资报告、股权转让协议、增资协议、 纳税凭证;
 - 2、查阅了发行人对26名投资机构签署的对赌协议及其补充协议;
 - 3、与发行人及其控股股东、实际控制人、全体股东逐一进行了访谈;
- 4、查阅了发行人、Hardeggs Holdings Limited、Optimum Profuse Limited、 优车易购(香港)工商资料:
- 5、查阅了Trinity Corporate Finance Limited出具的评估报告《Opinion On The Business Valuations Of The Acquisition Group And Disposal Group Relating To The Hardeggs Restructuring》;
 - 6、查阅了优车易购(香港)向发行人出资的银行凭证;
 - 7、查阅了优车易购历次增资及股权转让的相关协议、价款支付凭证;
- 8、就优车易购(香港)入股、减持事宜与发行人、控股股东及其实际控制人、优车易购(香港)实际控制人沈兵逐一访谈;

- 9、取得了发行人、控股股东硬蛋创新、优车易购(香港)及深圳优车易购 出具的《确认函》;
- 10、查阅沈兵个人及其控制的优车易购(香港)、深圳优车易购银行流水, 硬蛋创新涉及优车易购(香港)相关股权转让款项的银行流水,核查其中与发行 人主要关联方、客户、供应商的往来情况及合理性;
- 11、取得并查阅了相关投资人出具的《深圳市科通技术股份有限公司股东确 认函》;
 - 12、查阅远瞻通信与沈兵签订的委托贷款协议,以及远瞻通信提款证明:
 - 13、查阅了远瞻通信出具的说明文件;
- 14、查阅了瑞信杰创与优车易购签订的《借款协议》及《三方债权债务承继 协议》;
- 15、查阅了优车易购(香港)股权投资、购买理财产品的相关投资协议、理 财产品相关基金管理人出具的确认函,并与基金管理人相关人员逐一访谈核实理 财产品相关情况。

(二)核查意见

经核查,保荐人、发行人律师认为:

- 1、优车易购(香港)实际控制人沈兵于 2016 年按照 2,300 万元的估值取得 Hardeggs Holdings Limited 股权,后又于 2019 年按照约 3.5 亿元估值"换股"取得发行人股份,后续于 2020-2022 年期间以 24 亿及 29 亿元估值进行退出,沈兵在 4 年以上的投资期间的收益已达预期。因此,优车易购(香港)入股发行人后出让发行人股份,并在发行人本次申报前退出发行人具备商业合理性。
- 2、优车易购(香港)及其相关方出让发行人股权后,按照协议支付至硬蛋 创新的款项及保证金,硬蛋创新未对前述款项进行专项管理,将相关款项用于日 常营运资金,最终主要支付予硬蛋创新供应商。

截至本落实函回复出具日,优车易购(香港)将股权转让款所购买的理财产 品均未到期,所进行的股权投资未设定投资期限,深圳优车易购亦未退出该等股 权投资。上述投资、理财真实。 不存在优车易购(香港)及其相关方出让发行人股权所得款为发行人提供体外资金循环、资金闭环回流等情况。

3、2021年12月,发行人、深圳市优车易购科技有限公司、康敬伟与上述6名投资者签订《<股权转让协议>之补充协议》,该协议中约定如发行人就上市事宜向证券交易所递交的申请材料主动或被动撤回的、发行人本次上市申请被证券交易所或中国证监会否决等情形,则6名投资者有权要求恢复原股权转让协议的回购权,即原股东深圳市优车易购科技有限公司按照原股权转让协议约定承担回购义务且发行人实际控制人康敬伟就原股东深圳市优车易购科技有限公司的回购义务承担连带保证责任。

为按照投资者要求为原股东深圳市优车易购科技有限公司的回购义务承担 连带保证责任,基于实际控制人本身权益考量及确保深圳市优车易购科技有限公 司能够按照约定履行回购义务,实际控制人要求优车易购(香港)向硬蛋创新提 供一定金额作为保证金作实际控制人为深圳市优车易购科技有限公司提供连带 保证责任的履约保证金,该等安排具备合理性。此外,除优车易购(香港)外, 其他承诺方未提供保证金。

截至本落实函回复出具日,除股权回购条款终止附有效力恢复条款外,对赌协议所涉其他特殊安排条款均已终止。

问题 4. 关于信息披露

申报材料及审核问询回复显示,发行人所属行业为批发业,从事电子元器件分销业务,主要通过购销差价获得利润。

请发行人修订招股说明书等信息披露文件内容,完善关于发行人主营业务在产业链中的环节以及作用、与上游供应商分工等相关信息披露事项,客观、准确、 浅白地呈现发行人主营业务及竞争格局、发行人核心竞争力等,避免夸大性或误导性陈述。

回复:

发行人已修订招股说明书等信息披露文件内容,完善了关于发行人主营业务 在产业链中的环节以及作用、与上游供应商分工等相关信息披露事项,已尽量客 观、准确、浅白地呈现发行人主营业务及竞争格局、发行人核心竞争力等。主要 修订情况如下表所示:

文件名称	具体修订位置	修订情况说明
	"第五节 业务和技术"	将"芯片应用设计"修改为"芯片应用技术",将"芯片应用设计服务"修改为"芯片应用设计服务",将"芯片应用设计方案"修改为"芯片应用设计方案"修改为"芯片应用技术方案"
《招股说明书》	"第五节 业务和技术"之"一、发行人主营业务、主要产品或服务情况"之 "(一)公司经营的主要业务和主要产品或服务"	完善了关于发行人主营业务及 其在产业链中的环节以及作用 等相关信息披露事项
W10100 00 71 17//	"第五节 业务和技术"之"一、发行人主营业务、主要产品或服务情况"之 "(六)公司创新、创造、创意特征及 科技创新、模式创新、业态创新与新旧 产业融合情况"	完善了关于发行人与上游供应 商、下游客户分工等相关信息 披露事项
	"第五节 业务和技术"之"二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况"之 "(四)发行人产品或服务的市场地位、技术水平及特点"	完善了发行人竞争格局、发行 人核心竞争力等相关信息披露 事项
《第一轮审核问询函的回复》	"第1题 关于创业板定位与主营业务"	(1) 将"芯片应用设计"修改为"芯片应用技术",将"芯片应用技术",将"芯片应用技术服务"修改为"芯片应用技术服务",将"芯片应用设计方案"修改为"芯片应用技术方案" (2) 完善了关于发行人与上游供应商、下游客户分工等相关

文件名称	具体修订位置	修订情况说明
		信息披露事项
《第二轮审核问询函的回复》	"第1题 关于核心技术、研发人员与创业板定位"	将"芯片应用设计"修改为"芯片应用技术",将"芯片应用 设计服务"修改为"芯片应用 技术服务",将"芯片应用设 计方案"修改为"芯片应用技术方案"修改为"芯片应用技术方案"

发行人已同步在《首次公开发行股票并在创业板上市的申请报告》、《关于符合创业板定位要求的专项说明》等文件中同步修改相关表述。

(本页无正文,为《关于深圳市科通技术股份有限公司申请首次公开发行股票并 在创业板上市的审核中心意见落实函的回复》之盖章页)

深圳市科通技术股份有限公司

发行人董事长声明

本人已认真阅读《关于深圳市科通技术股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函的回复》的全部内容,确认本回复不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人董事长:

事気は

深圳市科通技术股份有限公司

(本页无正文,为华泰联合证券有限责任公司《关于深圳市科通技术股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函的回复》的签章页)

保荐代表人:

月花3

金巍锋

华泰联合证券有限责任公司

保荐机构法定代表人声明

本人已认真阅读深圳市科通技术股份有限公司本次落实函回复的全部内容,了解落实函回复涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程,确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序,落实函回复中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构法定代表人:

江馬

华茶联合证券有限页性公司